

**Molex 55100-0670 PDF**

**molex<sup>®</sup>**

深圳创唯电子有限公司

**<http://www.molex-connect.com>**

組み立て手順書

ASSEMBLY PROCEDURE

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、2. 0mm PITCH I/O コネクタ に於いて  
下記構成部品とケーブルの組み立て方法について適用する。

THIS ASSEMBLY PROCEDURE SPECIFIES THE METHOD OF ASSEMBLING THE  
UNDERMENTIONED COMPOSITION PARTS AND CABLE IN 2.0mm PITCH I/O CONN.

1-1. 品名及び、部品番号 NAME AND PART NUMBER

品名 NAME		部品番号 PART NUMBER	
プラグ セット PLUG SET 55100-0**0	電線半田付タイプ SOLDER TYPE	半田付式プラグ SOLDER TYPE PLUG	54180-0*19
	シェルカバー SHELL COVER		58299-0*26
	シェルボディ SHELL BODY		58300-0*26
	モールドカバーA MOLD COVER A		54181-0*15
	モールドカバーB MOLD COVER B		54182-0*05

\* : 図面参照 Refer to the drawings.

REV.	A	B																			
SHEET	30	32																			
REVISE ON PC ONLY										TITLE:											
<b>B</b>	改訂 REVISED 122501 2017/10/04 ESATO									<b>2.0mm PITCH I/O CONNECTOR アプリケーション仕様書</b>											
	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																				
REV.	DESCRIPTION																				
DESIGN CONTROL J					STATUS					WRITTEN BY: ESATO	CHECKED BY: KTAKAHASHI	APPROVED BY: NUKITA	DATE: 2017/09/20								
DOCUMENT NUMBER 551000680AS										DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER							SHEET 1 OF 32		

品名 NAME	部品番号	PART NUMBER
ソケットセット SOCKET SET 54280-0*09 (SOLDER TYPE)	半田付式ソケット SOLDER TYPE SOCKET	53988-0*19
	シェルカバー SHELL COVER	58302-0*28
	モールドカバーA MOLD COVER A	53989-0*05
	モールドカバーB MOLD COVER B	53990-0*05
ソケットセット SOCKET SET 500655-0*09 (CRIMP TYPE)	圧着式ソケット CRIMP TYPE SOCKET	500653-0*19
	シェルカバー SHELL COVER	58302-0*28
	モールドカバーA MOLD COVER A	53989-0*05
	モールドカバーB MOLD COVER B	53990-0*05
ソケットセット SOCKET SET 500655-0*19 (CRIMP TYPE PANEL MOUNT)	圧着式ソケット CRIMP TYPE SOCKET	500653-0*19
	シェルカバー SHELL COVER	58302-0*28
	モールドカバーA MOLD COVER A	53989-0*15
	モールドカバーB MOLD COVER B	53990-0*15
セット共通部品 SET COMMON PARTS	ケーブルクランプ CABLE CLAMP	58303-0000
	十字穴付きなべ小ネジ CROSS RECESSED PAN HEAD MACHINE SCREW	59832-0009

\* : 図面参照 Refer to the drawings.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 2 OF 32
EN-127(2015-12)				

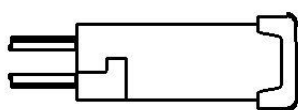
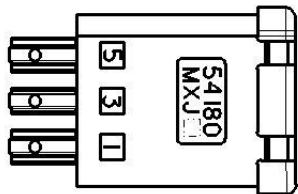
1 - 2. 適用電線 APPLICABLE CABLES

		半田付式 SOLDER TYPE		圧着式 CRIMP TYPE
導体 CONDUCTOR	AWG	#16 MAX.	#22 MAX.	#28~#22
	回路番号 (6極品) CKTS. NO. (6 CKTS.)	1,2,5,6	3,4	全極 ALL CKTS.
	回路番号 (8極品) CKTS. NO. (8 CKTS.)	1,2,7,8	3,4,5,6	
被覆外径 INSULATION O.D		φ2.1 MAX.	φ1.2 MAX.	φ1.2 MAX.
仕上がり外径 FINISH O.D		φ6.2 ~ φ7.2		

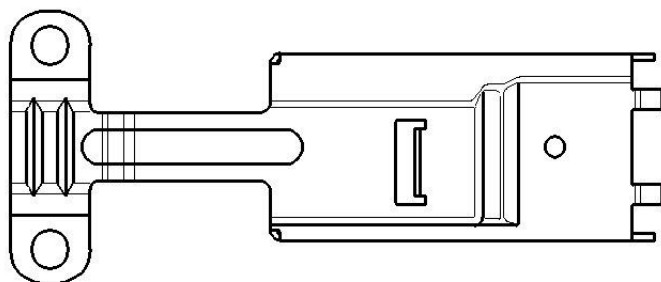
REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR</b> <b>アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 3 OF 32

【2. 各部の名称 PART NAME】

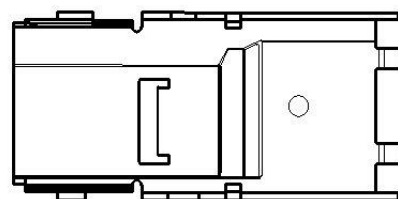
2-1. プラグ 各部の名称 PLUG SET PART NAME



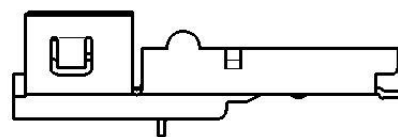
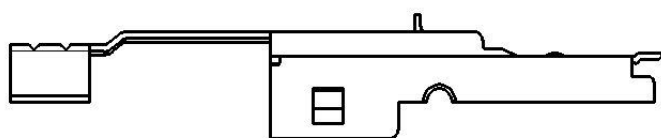
半田付式プラグ  
SOLDER TYPE PLUG  
54180-0\*19



シェルカバー  
SHELL COVER  
58299-0\*26



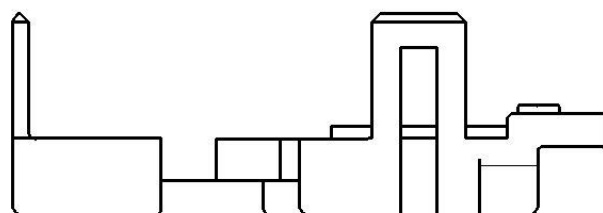
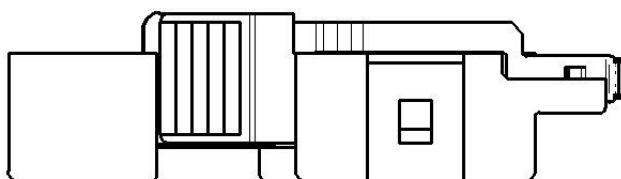
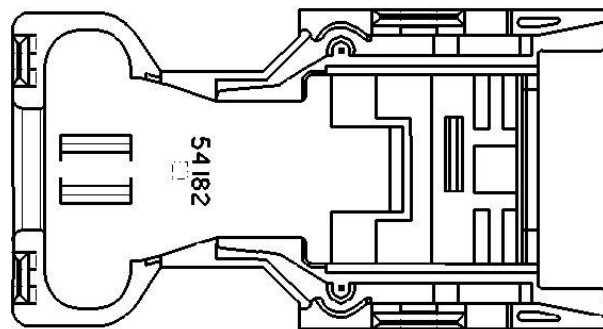
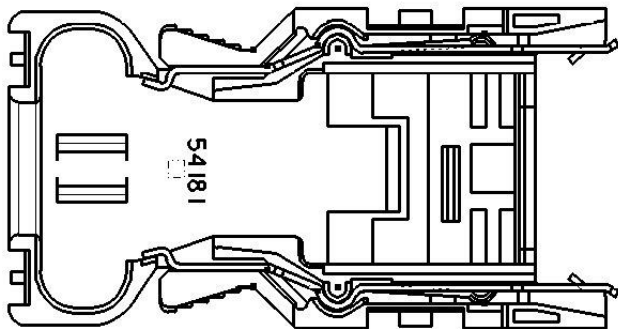
シェルボディ  
SHELL BODY  
58300-0\*26



REVISE ON PC ONLY	
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32
REV.	DESCRIPTION

TITLE: <b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER 551000680AS	DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER	SHEET 4 OF 32
--------------------------------	-----------------	------------------	----------	------------------



モールドカバーA  
MOLD COVER A  
54181-0\*15

モールドカバーB  
MOLD COVER B  
54182-0\*05

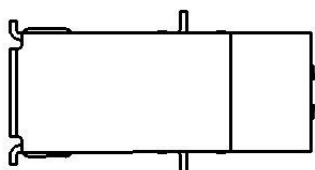
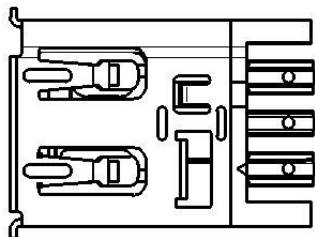
[注意事項 NOTES]

(1) モールドカバーA (54181-0\*15) は、既にスプリングラッチが組み込まれているため  
外すことが無いように注意すること。

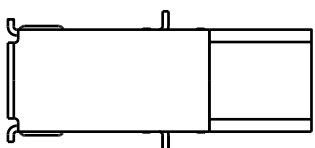
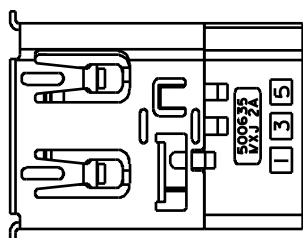
DO NOT REMOVE LATCHES PRE-ASSEMBLED TO MOLD COVER A (54181-0\*15).

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 5 OF 32
EN-127(2015-12)				

2-2. ソケット各部の名称 SOCKET SET PART NAME

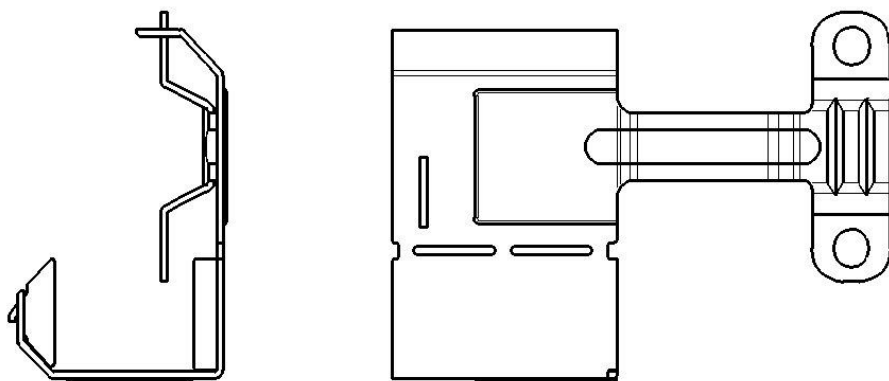


半田付式ソケット  
SOLDER TYPE SOCKET  
53988-0\*19

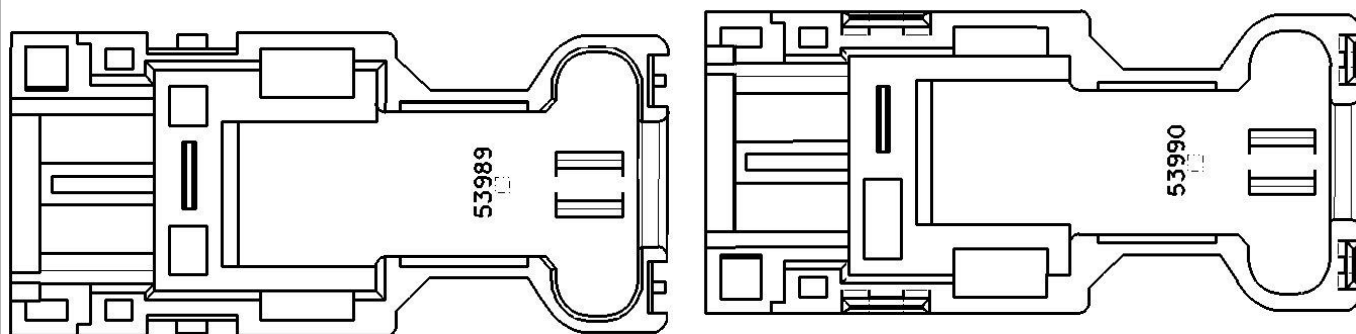


圧着式ソケット  
CRIMP TYPE SOCKET  
500653-0\*19

<b>B</b>	REVISE ON PC ONLY	TITLE: <b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR</b> <b>アプリケーション仕様書</b>			
	SEE SHEET 1 OF 32				
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER	SHEET 6 OF 32

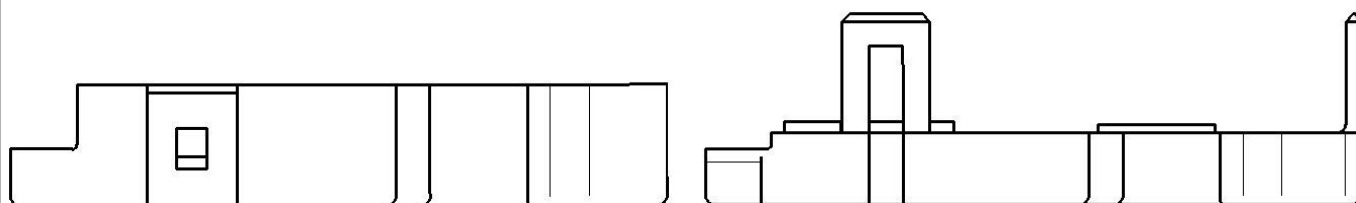


シェルカバー  
SHELL COVER  
58302-0\*28



モールドカバーA  
MOLD COVER A  
53989-0\*05

モールドカバーB  
MOLD COVER B  
53990-0\*05

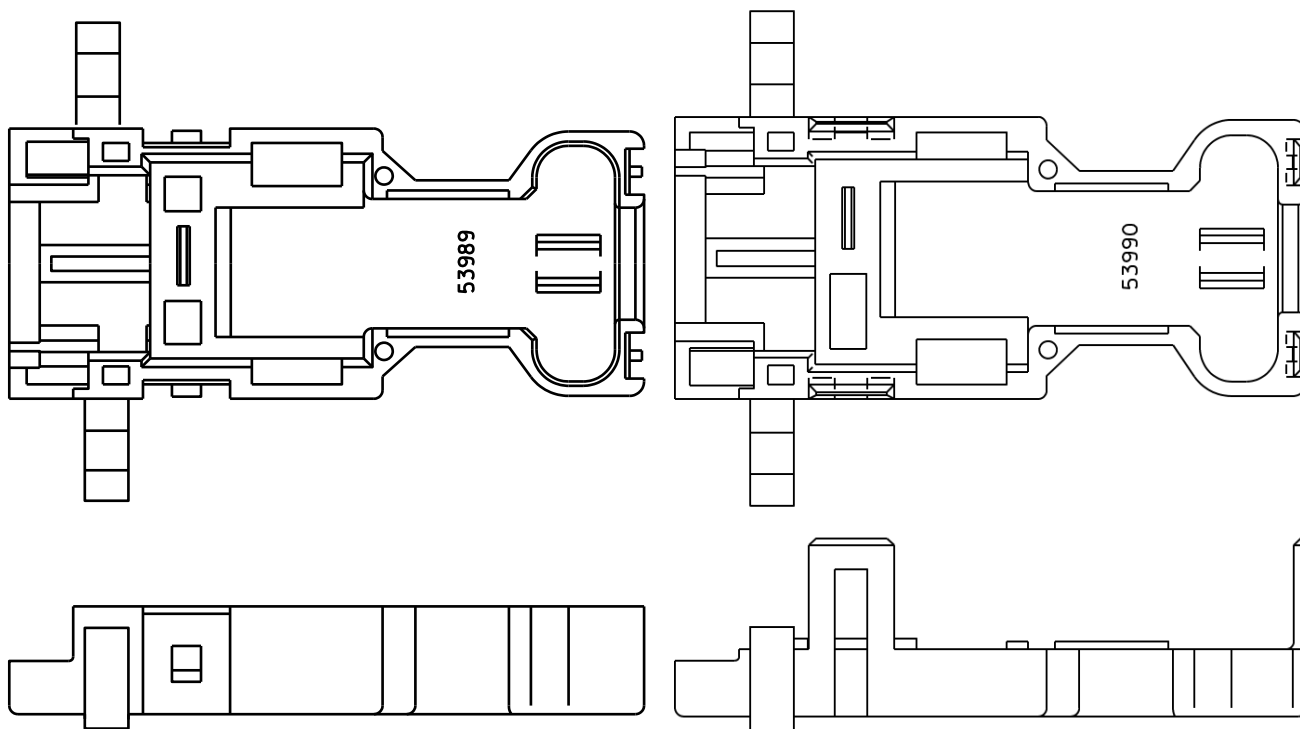


REVISE ON PC ONLY	
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32
REV.	DESCRIPTION

TITLE:	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			

DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>	DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER	SHEET 7 OF 32
---------------------------------------	------------------------	-------------------------	----------	------------------



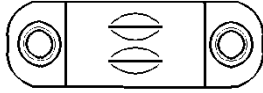


モールドカバーA(パネルマウント)  
MOLD COVER A(PANEL MOUNT)  
53989-0\*15

モールドカバーB(パネルマウント)  
MOLD COVER B(PANEL MOUNT)  
53990-0\*15

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
	<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR</b> <b>アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER	SHEET 8 OF 32
EN-127(2015-12)					

2-3. セット共通部品の名称 SET COMMON PARTS NAME



ケーブルクランプ  
CABLE CLAMP  
58303-0000



十字穴付きなべ小ネジ  
CROSS RECESSED PAN HEAD MACHINE SCREW  
59832-0009

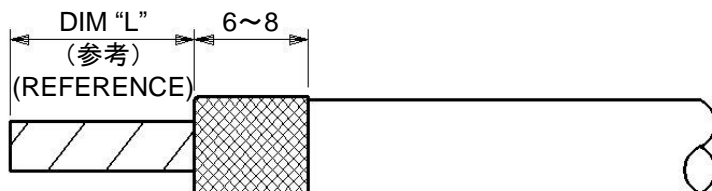
【3. プラグコネクタの組み立て方法 ASSEMBLING PROCEDURE FOR PLUG CONNECTOR HARNESS】

3-1. ケーブルの端末処理 CABLE TERMINATION PROCEDURE

3-1-1. シース剥ぎ長さ SHEATH STRIPPING LENGTH

シースを剥ぎ、編組シールドを適合寸法まで切断し、シースに均一に折り返す。

STRIP SHEATH, AND CUT-OFF OUTER BRAIDED SHIELD AT THE OPTIMUM LENGTH, AND TURN UP UNIFORMLY.



結線方法 WIRE TERMINATION METHOD	DIM "L"
半田付式 SOLDER TYPE	22

[注意事項 NOTES]

- (1) シースを除去する時、編組シールドを傷つけないこと。  
DO NOT DAMAGE BRAIDED SHIELD WHEN STRIPPING SHEATH.
- (2) 編組シールドを折り返すとき、編組を崩さないこと。  
DO NOT LOOSEN CABLE BRAID WHEN TURNING IT UP.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 9 OF 32
EN-127(2015-12)				

(3) シース径が細い場合は、シース径を調整すること。

シース径調整用部材としては、ハーネス作業時に発生するシースの廃材等を所定の大きさに切断して、適合するシース径まで巻き付けご使用ください。

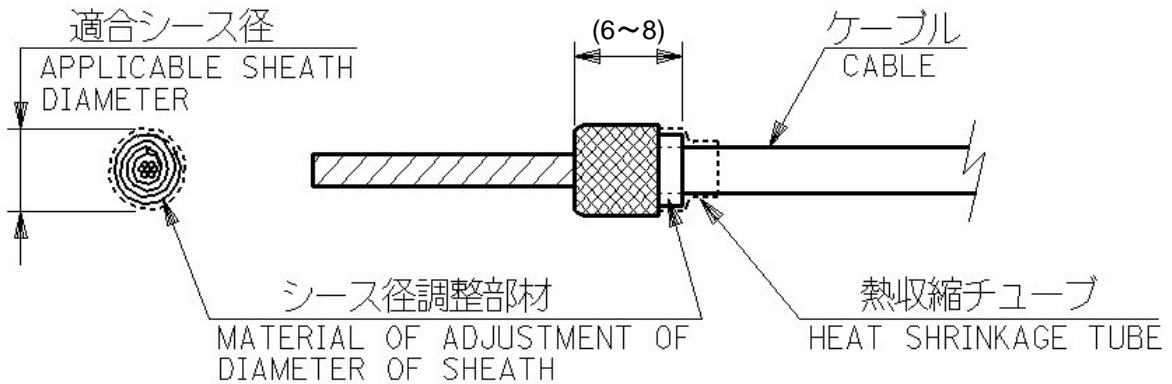
(必要により熱収縮チューブをご使用ください。)

また、シース径調整用部材を取り付けた場合は、編組シールドはシース径調整用部材の外周に折り返すこと。

IF THE DIAMETER OF SHEATH IS STILL SMALL, ADJUST THE DIAMETER OF SHEATH.

PLEASE USE THE SCRAP, ETC. OF THE SHEATH GENERATED WHEN THE HARNESS WORKING AS A MATERIAL OF THE ADJUSTMENT OF THE DIAMETER OF SHEATH. AND USE THE HEAT SHRINKAGE TUBE IF NECESSARY.

WHEN TO INSTALL THE MATERIAL OF THE ADJUSTMENT OF THE DIAMETER OF SHEATH, TURN THE BRAIDED SHIELD IN OUTER OF THE DIAMETER ADJUSTMENT MATERIAL.



REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 10 OF 32
EN-127(2015-12)				

## 3-1-2. 銅箔テープ巻き COPPER FOIL TAPING

(1) 折り返した編組に粘着材付き銅箔テープを約1.5週巻く。

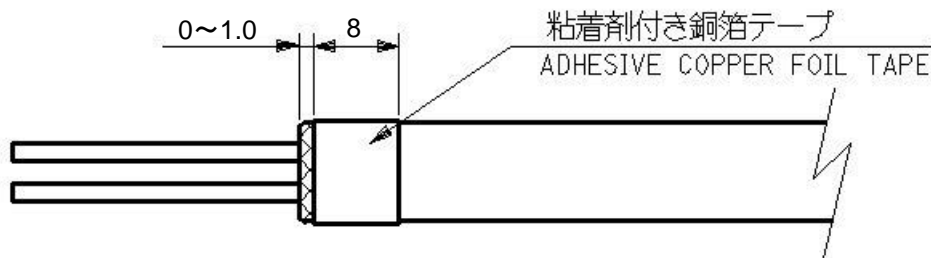
WIND ADHESIVE COPPER FOIL TAPE ROUND UP-TURNED BRAID BY  
1 TURN AND A HALF OR SO.

・銅箔テープ : W=8 T=0.1 L=40 3 M製、タイプ1245相当品

COPPER FOIL TAPE : W=8 T=0.1 L=40 3 M MADE , TYPE 1245 OR THE EQUALS

(2) 銅箔テープを巻いた後、紙テープ及び介在（綿糸）を根元から切断する。

AFTER COPPER FOIL TAPING, CUT OFF PAPER TAPE AND FILLER  
(COTTON THREAD) AT THE BOTTOM.



### [注意事項 NOTES]

(1) 銅箔テープの末端は、剥がれないようにとめること。

STICK COPPER FOIL TAPE END EXACTLY.

(2) テープ、介在を切断する場合は、引きちぎらないではさみ等で切断すること。

DO NOT TEAR OFF TAPE AND FILLER. CUT THEM WITH A KNIFE OR A PAIR  
OF SCISSORS.

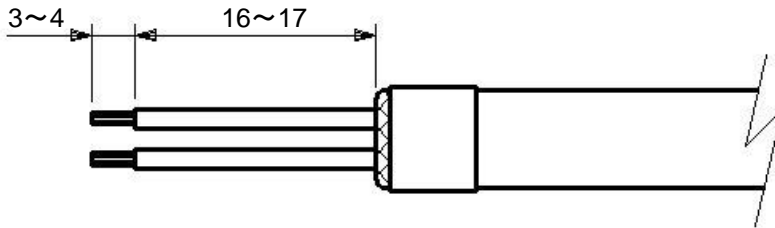
REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER
				SHEET 11 OF 32
EN-127(2015-12)				

## 3-2. 電線の結線 WIRE TERMINATION

### 半田付け SOLDERING

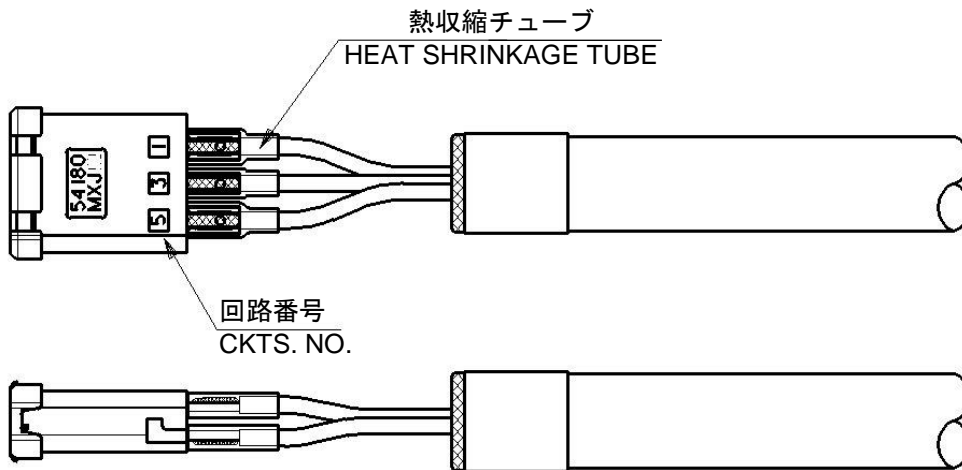
- (1) 電線の被覆を剥ぎ、芯線に半田上げ処理を行う。

STRIP INSULATION OF CABLE AND PRE-SOLDER.



- (2) 半田上げ処理された電線に熱収縮チューブを通してから半田付け式プラグ (54180-0\*19) の各々の極に半田付けを行う。

THE HEAT SHRINKAGE TUBE IS PASSED THROUGH THE PRE-SOLDERED WIRE, AND SOLDER PRE-SOLDERED WIRES EACH TO SOLDER TAILS OF SOLDER TYPE PLUG. (PART NO. 54180-0\*19)



REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 12 OF 32
EN-127(2015-12)				

[注意事項 NOTES]

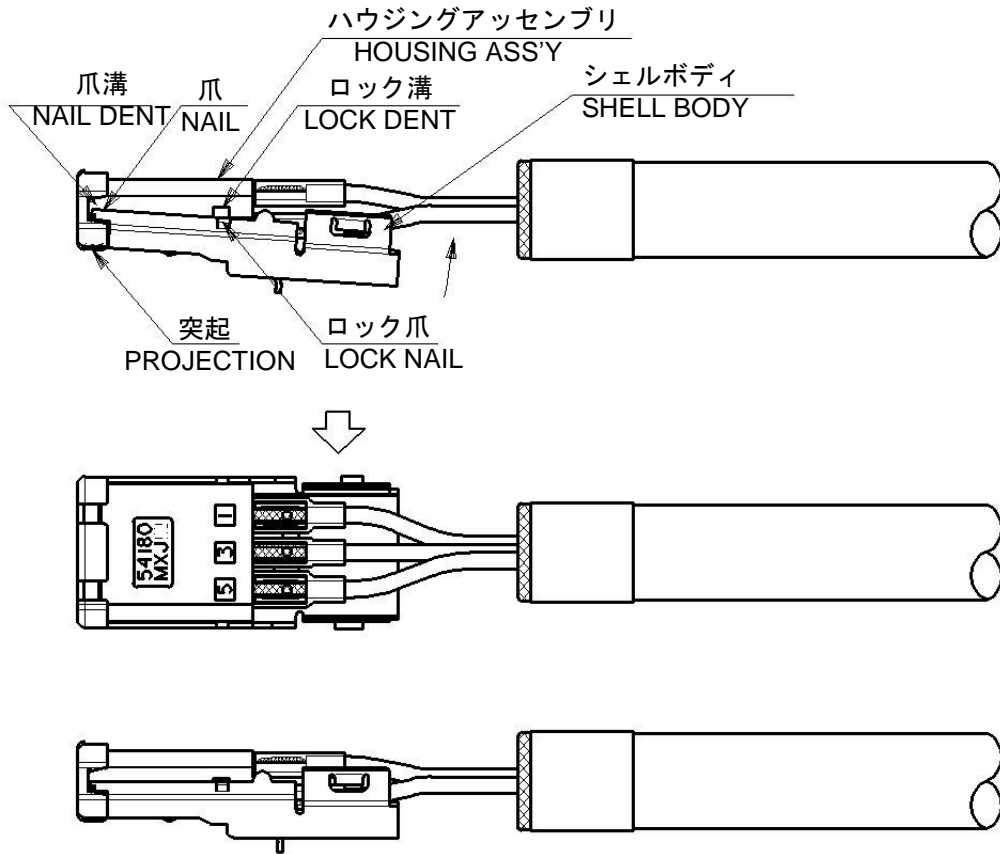
- (1) 半田ごては、こて先の細い半田ごてを使用すること。  
USE A SOLDERING IRON WITH SHARP TIP END.
- (2) 半田付け作業は、350°C、5秒以内に行うこと。  
SOLDER UNDER CONDITION OF 350°C FOR 5 SECONDS MAX.
- (3) 半田ごて先で端子に力を加えターミナルを動かさないようにすること。  
APPLY SLIGHT FORCE TO TERMINAL WITH A TIP END OF SOLDERING IRON  
SO THAT IT DOES NOT MOVE WHEN SOLDERING.
- (4) 半田付け終了後すぐに電線に張力を加えないこと。  
DO NOT APPLY TENSILE FORCE TO CABLE JUST AFTER SOLDERING.
- (5) 半田付け部は、熱収縮チューブで絶縁すること。  
COVER, AND INSULATE THE HEAT SHRINKAGE TUBE IN THE SOLDERING PART.  
熱収縮チューブ（参考）：スミチューブF2Z（住友電工）相当品。  
HEAT SHRINKAGE TUBE: SUMITUBE F2Z (SUMITOMO DENKO) CORRESPONDING.  
(REFERENCE)

<b>B</b>	REVISE ON PC ONLY	TITLE: <b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR</b> <b>アプリケーション仕様書</b>			
	SEE SHEET 1 OF 32				
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER	SHEET 13 OF 32
EN-127(2015-12)					

3-3. シェルボディの組み立て SHELL BODY ASSEMBLING

3-2項の結線が完了したハウジングアセンブリにシェルボディを装着する。

AFTER WIRE TERMINATION OF PARAGRAPH 3-2., SHELL BODY TO HOUSING ASS'Y.



[注意事項 NOTES]

- (1) シェルボディを装着する場合、斜めに先端の爪を爪溝に引っかけた後、ハウジングのロック溝にシェルのロック爪を合わせる。

この時、傾け過ぎると2本の突起の変形が発生するので注意すること。

WHEN ASSEMBLING SHELL BODY TO PLUG HOUSING, SET LOCK NAIL OF SHELL BODY TO LOCK DENT OF HOUSING WHILE HOOKING TIP END PROJECTION SLANTINGLY TO NAIL DENT.

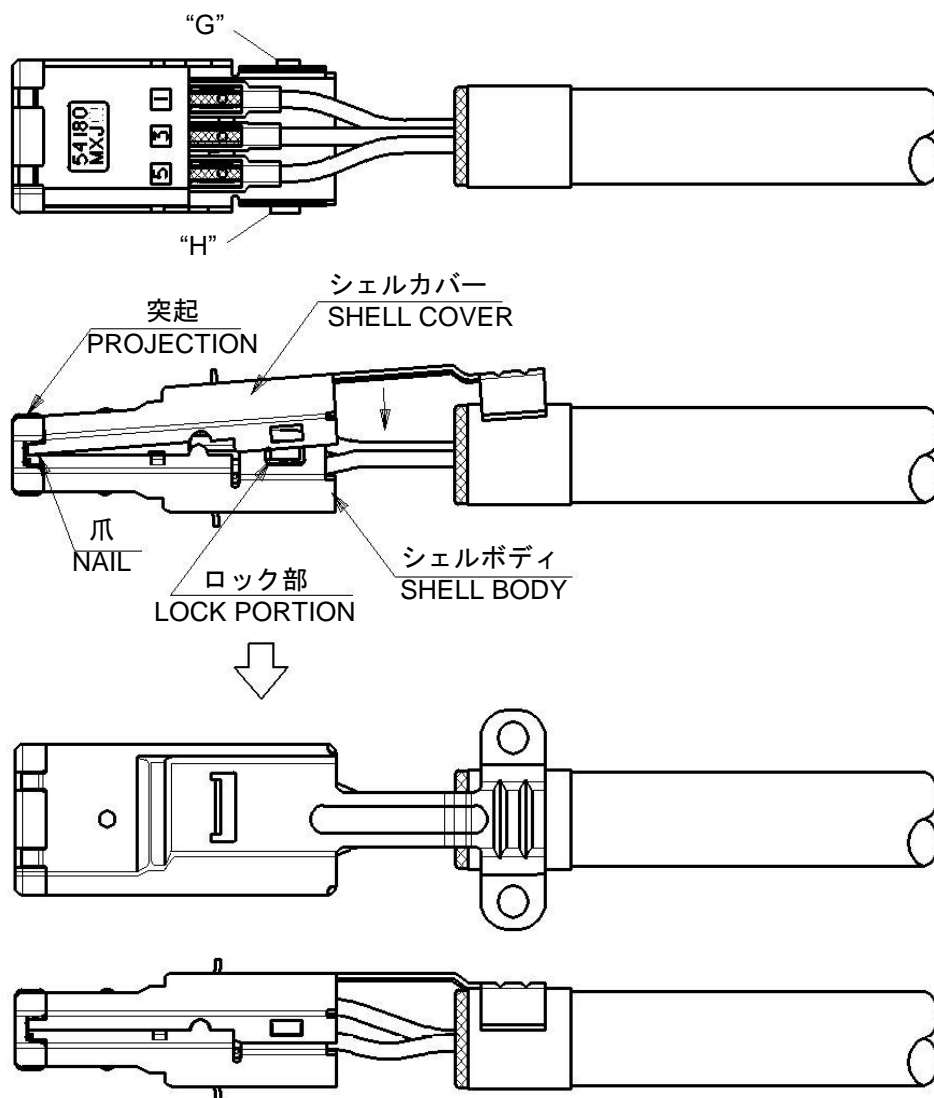
PAY ATTENTION TO DEFORMATION OF A PAIR OF PROJECTION AT THIS TIME.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER
				SHEET 14 OF 32

3-4. シェルカバーの組み立て SHELL COVER ASSEMBLING

3-3項の装着が完了したシェルボディにシェルカバーを装着する。この時、シェルカバーとシェルボディの合わせは、下図G、H部の2箇所所でロックする。

ASSEMBLE SHELL COVER TO AFTER ASSEMBLING SHELL BODY OF PARAGRAPH 3-3. SHELL COVER AND SHELL BODY TO BE LOCKED EXACTLY AT 2 POSITIONS, "G" AND "H" PORTIONS IN THE FOLLOWING FIGURE.



REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 15 OF 32
EN-127(2015-12)				



[注意事項 NOTES]

- (1) シェルカバーを装着する場合、斜めに先端の爪を爪溝に引っかけた後、シェルボディの爪部にカバーのロック部を確実にロックさせること。  
この時、傾け過ぎると2本の突起の変形が発生するので注意すること。

WHEN ASSEMBLING SHELL COVER TO SHELL BODY, HOOK TIP END NAILS OF COVER SLANTINGLY TO NAIL DENTS OF HOUSING AND LOCK EXACTLY. PAY ATTENTION TO DEFORMATION OF A PAIR OF PROJECTION AT THIS TIME.

- (2) シェルボディとシェルカバーを組み立てた後、シェルカバーを取り外す場合は、シェルカバーのロック部を小型ドライバー等により押し広げロックを解除し取り外すこと。  
取り外したシェルカバーを再度使用する場合は、ロック部の変形を修正すること。  
また、シェルボディの爪部の変形を修正すること。

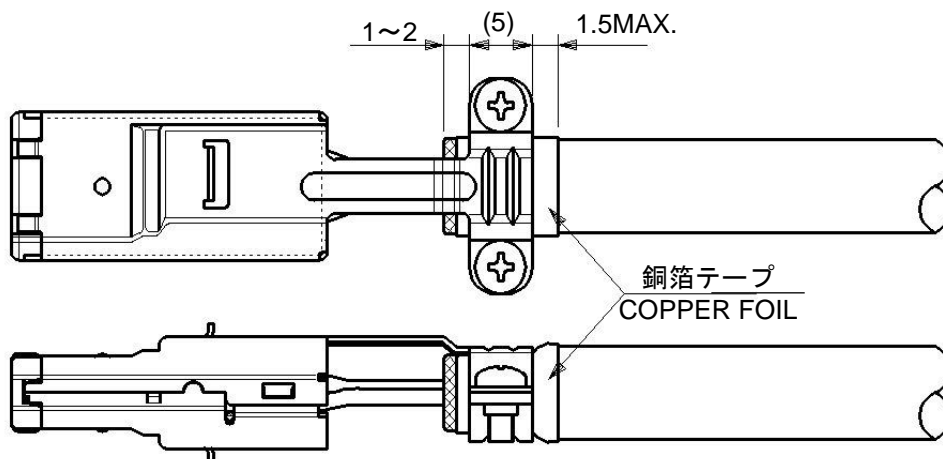
WHEN DETACHING SHELL COVER FROM SHELL BODY, UNLOCK SHELL COVER BY EXTENDING LOCK PORTION WITH A SCREW DRIVER. REPAIR THE DEFORMATION OF LOCK PORTION AND TIP END NAILS OF SHELL COVER WHEN USING THEM AGAIN.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE: <b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>			
	<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32				
REV.	DESCRIPTION		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>			DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER	SHEET 16 OF 32
EN-127(2015-12)						

3-5. ケーブルクランプ CABLE CLAMP ASSEMBLING TO SHELL ASSEMBLY

3-4項の組み立てが完了したシェルにケーブルクランプを装着する。

ASSEMBLE CABLE CLAMP TO AFTER ASSEMBLING SHELL OF PARAGRAPH 3-4.



ネジ締め付けトルク : 0.18~0.21Nm

RECOMMENDED SCREW TIGHTENING TORQUE : 0.18~0.21Nm

[注意事項 NOTES]

- (1) 電線には多少の弛みがあること。

MAKE WIRES HAVE SOME SAG AFTER SHELL ASSEMBLING.

- (2) ケーブルクランプからの銅箔テープのはみ出し量は、上記の通りとする。

はみ出し量が多い場合は、テープがカバーからはみ出すので注意すること。

THE AMOUNT OF THE OVERFLOW OF THE COPPER FOIL TAPE FROM THE CABLE CLAMPING IS MADE LIKE THE ABOVE-MENTIONED. NOTE THAT THE TAPE BEGINS TO SEE FROM THE COVER WHEN THE AMOUNT OF THE OVERFLOW IS LONG.

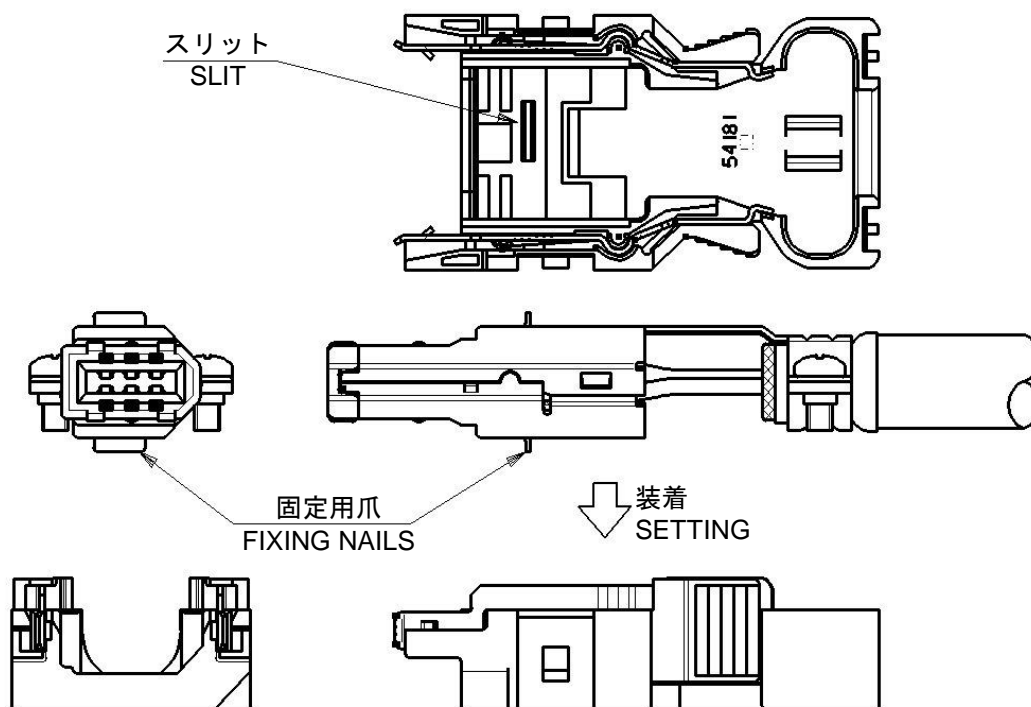
REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER
				SHEET 17 OF 32

3-6. モールドカバーへの組み込み MOLD COVER ASSEMBLING TO SHELL ASSEMBLY

3-6-1. モールドカバーAへのコネクタの装着 SHELL ASSEMBLY SETTING TO MOLD COVER A

カバーAに下図で示す方向にコネクタを装着する。

SET SHELL ASSEMBLY ON COVER A IN THE DIRECTION AS FOLLOWS.



[注意事項 NOTES]

(1) コネクタの固定用爪が、カバーAのスリットに確実に入ること。

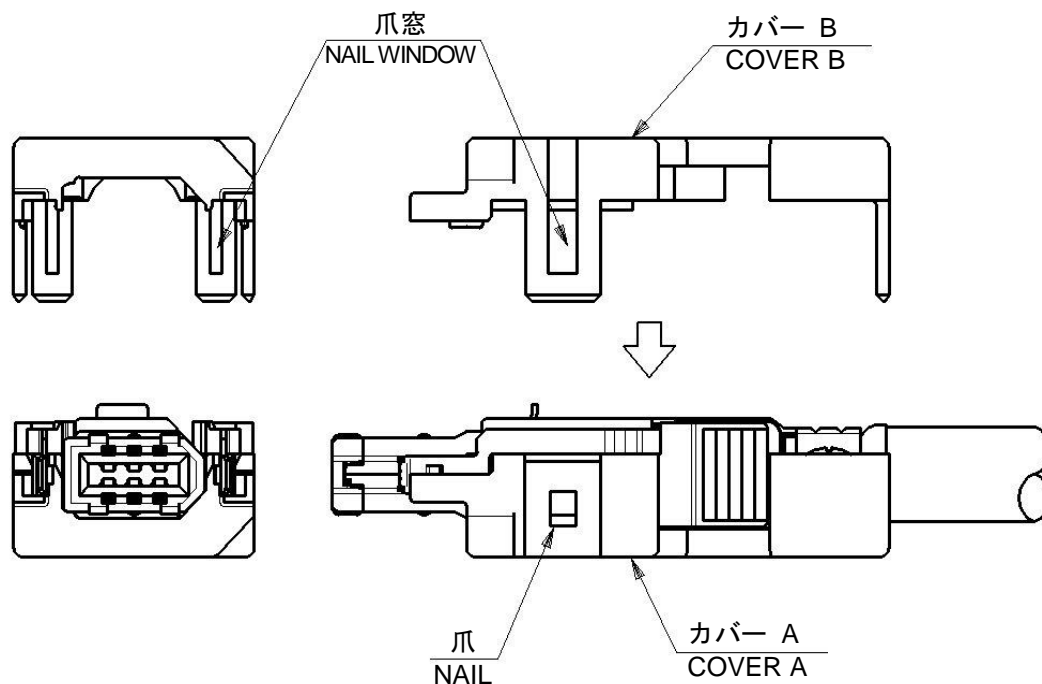
FIT FIXING NAILS OF SHELL ASSEMBLY IN THE SLIT OF COVER A EXACTLY.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 18 OF 32
EN-127(2015-12)				

## 3-6-2. モールドカバーBの装着 COVER B SETTING

カバーBをカバーAに装着する。

SET COVER B ON COVER A.



### [注意事項 NOTES]

- (1) モールドカバーAの爪にモールドカバーBのロック部（爪窓）を確実にロックさせること。（4個所）  
LOCK NAIL WINDOWS OF COVER B WITH NAILS OF COVER A EXACTLY. (4 POINTS)
- (2) カバ-装着後、ラッチが正常に作動すること。  
MAKE SURE OF NORMAL ACTION OF LATCHES AFTER ASSEMBLING.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 19 OF 32
EN-127(2015-12)				

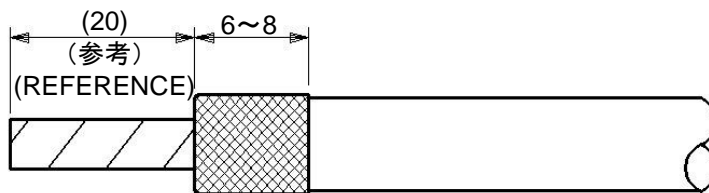
【4. ソケットコネクタの組み立て方法 ASSEMBLING PROCEDURE FOR SOCKET CONNECTOR HARNESS】

4-1. ケーブルの端末処理 CABLE TERMINATION PROCEDURE

4-1-1. シース剥ぎ長さ SHEATH STRIPPING LENGTH

シースを剥ぎ、編組シールドを適合寸法まで切断し、シースに均一に折り返す。

STRIP SHEATH, AND CUT-OFF OUTER BRAIDED SHIELD AT THE OPTIMUM LENGTH,  
AND TURN UP UNIFORMLY.



[注意事項 NOTES]

- (1) シースを除去する時、編組シールドを傷つけないこと。  
DO NOT DAMAGE BRAIDED SHIELD WHEN STRIPPING SHEATH.
- (2) 編組シールドを折り返すとき、編組を崩さないこと。  
DO NOT LOOSEN CABLE BRAID WHEN TURNING IT UP.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER
				SHEET 20 OF 32
EN-127(2015-12)				

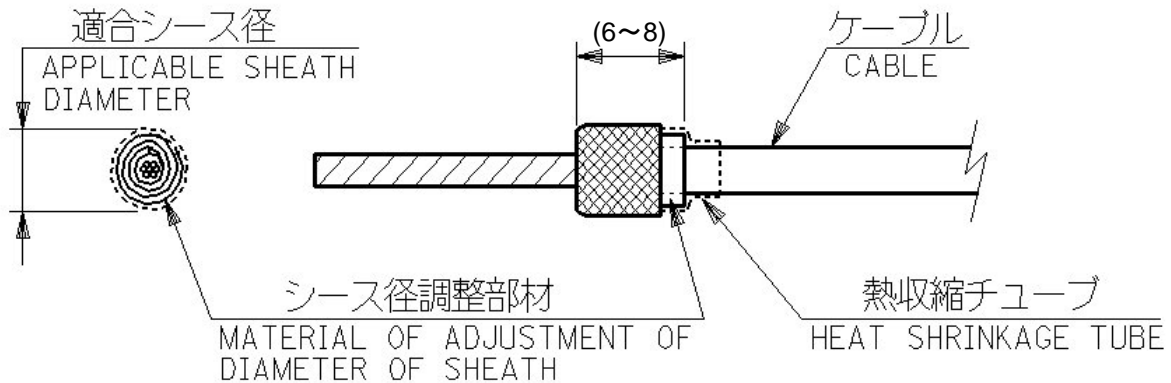
(3) シース径が細い場合は、シース径を調整すること。

シース径調整用部材としては、ハーネス作業時に発生するシースの廃材等を所定の大きさに切断して、適合するシース径まで巻き付けご使用ください。

(必要により熱収縮チューブをご使用ください。)

また、シース径調整用部材を取り付けた場合は、編組シールドはシース径調整用部材の外周に折り返すこと。

IF THE DIAMETER OF SHEATH IS STILL SMALL, ADJUST THE DIAMETER OF SHEATH. PLEASE USE THE SCRAP, ETC. OF THE SHEATH GENERATED WHEN THE HARNESS WORKING AS A MATERIAL OF THE ADJUSTMENT OF THE DIAMETER OF SHEATH. AND USE THE HEAT SHRINKAGE TUBE IF NECESSARY. WHEN TO INSTALL THE MATERIAL OF THE ADJUSTMENT OF THE DIAMETER OF SHEATH, TURN THE BRAIDED SHIELD IN OUTER OF THE DIAMETER ADJUSTMENT MATERIAL.



REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER
				SHEET 21 OF 32
EN-127(2015-12)				

**4-1-2. 銅箔テープ巻き COPPER FOIL TAPING**

(1) 折り返した編組に粘着材付き銅箔テープを約1.5週巻く。

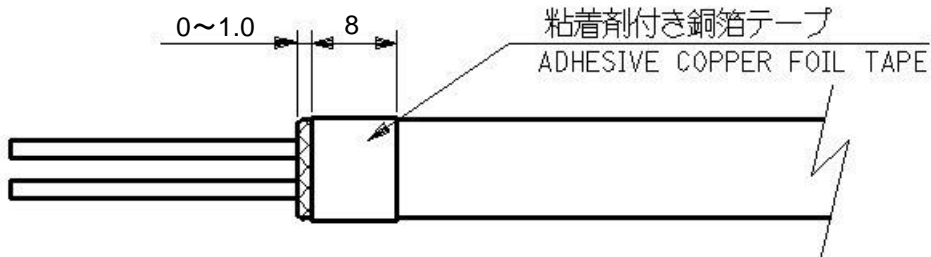
WIND ADHESIVE COPPER FOIL TAPE ROUND UP-TURNED BRAID BY 1 TURN AND A HALF OR SO.

・銅箔テープ : W=8 T=0.1 L=40 3M製、タイプ1245相当品

COPPER FOIL TAPE : W=8 T=0.1 L=40 3M MADE , TYPE 1245 OR THE EQUALS

(2) 銅箔テープを巻いた後、紙テープ及び介在（綿糸）を根元から切断する。

AFTER COPPER FOIL TAPING, CUT OFF PAPER TAPE AND FILLER (COTTON THREAD) AT THE BOTTOM.



[注意事項 NOTES]

(1) 銅箔テープの端末は、剥がれないようにとめること。

STICK COPPER FOIL TAPE END EXACTLY.

(2) テープ、介在を切断する場合は、引きちぎらないではさみ等で切断すること。

DO NOT TEAR OFF TAPE AND FILLER. CUT THEM WITH A KNIFE OR A PAIR

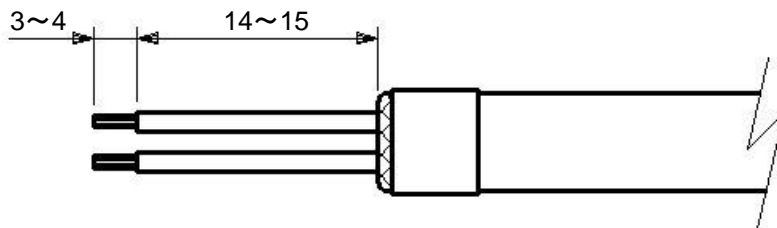
REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER
				SHEET 22 OF 32
EN-127(2015-12)				

## 4-2. 電線の結線 WIRE TERMINATION

### 4-2-1. 半田付け HAND SOLDERING

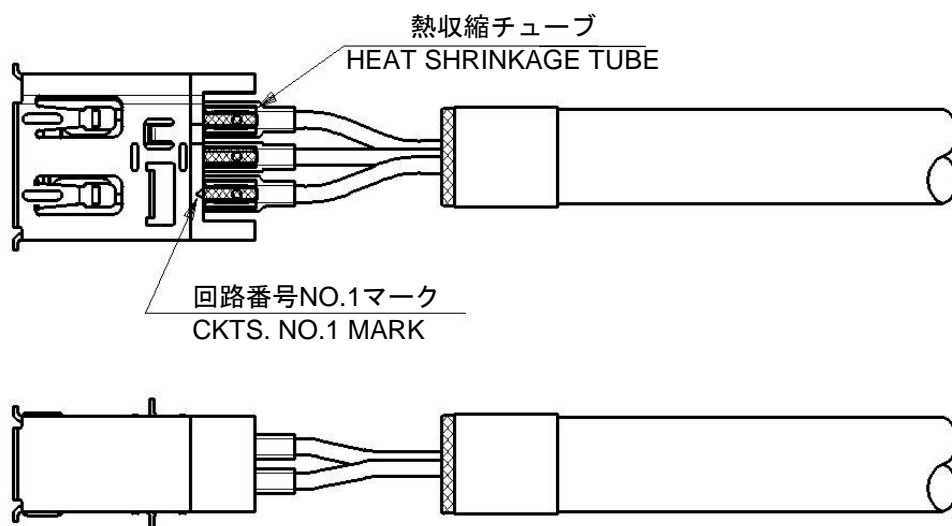
電線の被覆を剥ぎ、芯線に半田上げ処理を行う。

STRIP INSULATION OF CABLE AND PRE-SOLDER.



- (1) 半田上げ処理された電線に熱収縮チューブを通してから半田付式ソケット (53988-0\*19) の各々の極に半田付けを行う。

THE HEAT SHRINKAGE TUBE IS PASSED THROUGH THE PRE-SOLDERED WIRE, AND SOLDER PRE-SOLDERED WIRES EACH TO SOLDER TAILS OF SOLDER TYPE SOCKET. (PART NO. 53988-0\*19)



REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 23 OF 32
EN-127(2015-12)				



[注意事項 NOTES]

- (1) 半田ごては、こて先の細い半田ごてを使用すること。  
USE A SOLDERING IRON WITH SHARP TIP END.
- (2) 半田付け作業は、350°C、5秒以内に行うこと。  
SOLDER UNDER CONDITION OF 350°C FOR 5 SECONDS MAX.
- (3) 半田ごて先で端子に力を加えターミナルを動かさないようにすること。  
APPLY SLIGHT FORCE TO TERMINAL WITH A TIP END OF SOLDERING IRON  
SO THAT IT DOES NOT MOVE WHEN SOLDERING.
- (4) 半田付け終了後すぐに電線に張力を加えないこと。  
DO NOT APPLY TENSILE FORCE TO CABLE JUST AFTER SOLDERING.
- (5) 半田付け部は、熱収縮チューブで絶縁すること。  
COVER, AND INSULATE THE HEAT SHRINKAGE TUBE IN THE SOLDERING PART.  
熱収縮チューブ（参考）：スミチューブF2Z（住友電工）相当品。  
HEAT SHRINKAGE TUBE: SUMITUBE F2Z (SUMITOMO DENKO) CORRESPONDING.  
(REFERENCE)

<b>B</b>	REVISE ON PC ONLY	TITLE: <b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR</b> <b>アプリケーション仕様書</b>			
	SEE SHEET 1 OF 32				
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER	SHEET 24 OF 32
EN-127(2015-12)					

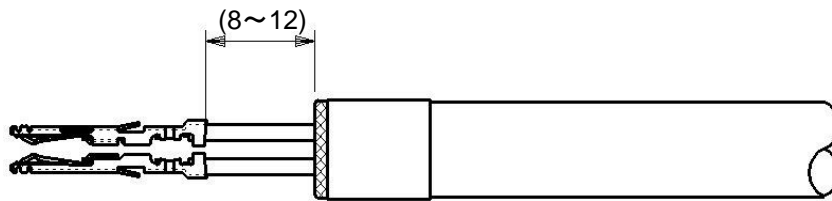
4-2-2. 圧着 CRIMPING

(1) ターミナル圧着 TERMINAL CRIMPING

適用圧着工具を使用し、圧着仕様書（CS-50639）に基づき圧着を行う。

圧着後の電線寸法は、下図の通りとする。（参考）

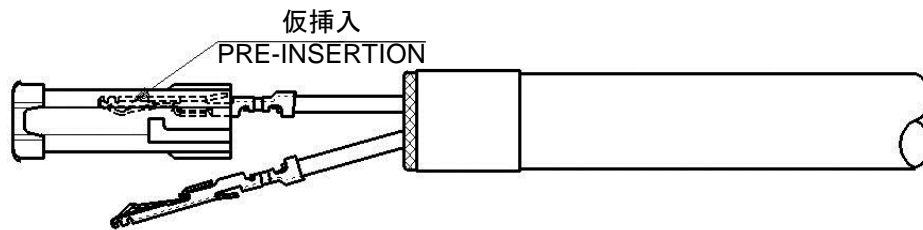
CRIMP WIRES TO TERMINAL WITH EXCLUSIVE CRIMPING TOOLS BASED UPON CRIMPING SPECIFICATION (CS-50639). WIRE DIMENSION AFTER CRIMPING TO BE AS FOLLOWS. (REFERENCE)



(2) ターミナル挿入 TERMINAL INSERTION TO THE HOUSING

ケーブルの全極を圧着した後、圧着プラグハウジングの適合位置に片列側を仮挿入し本挿入を行う。次に、残りの片列を仮挿入し本挿入を行う。

AFTER CRIMPING, PRE-INSERT TERMINALS ON ONE SIDE INTO HOUSING, AND INSERT THEM FULLY AGAIN. AND PROCEED TO ANOTHER SIDE.



本図は参考図とする  
This figure is a reference

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER
				SHEET 25 OF 32
EN-127(2015-12)				

[注意事項 NOTES]

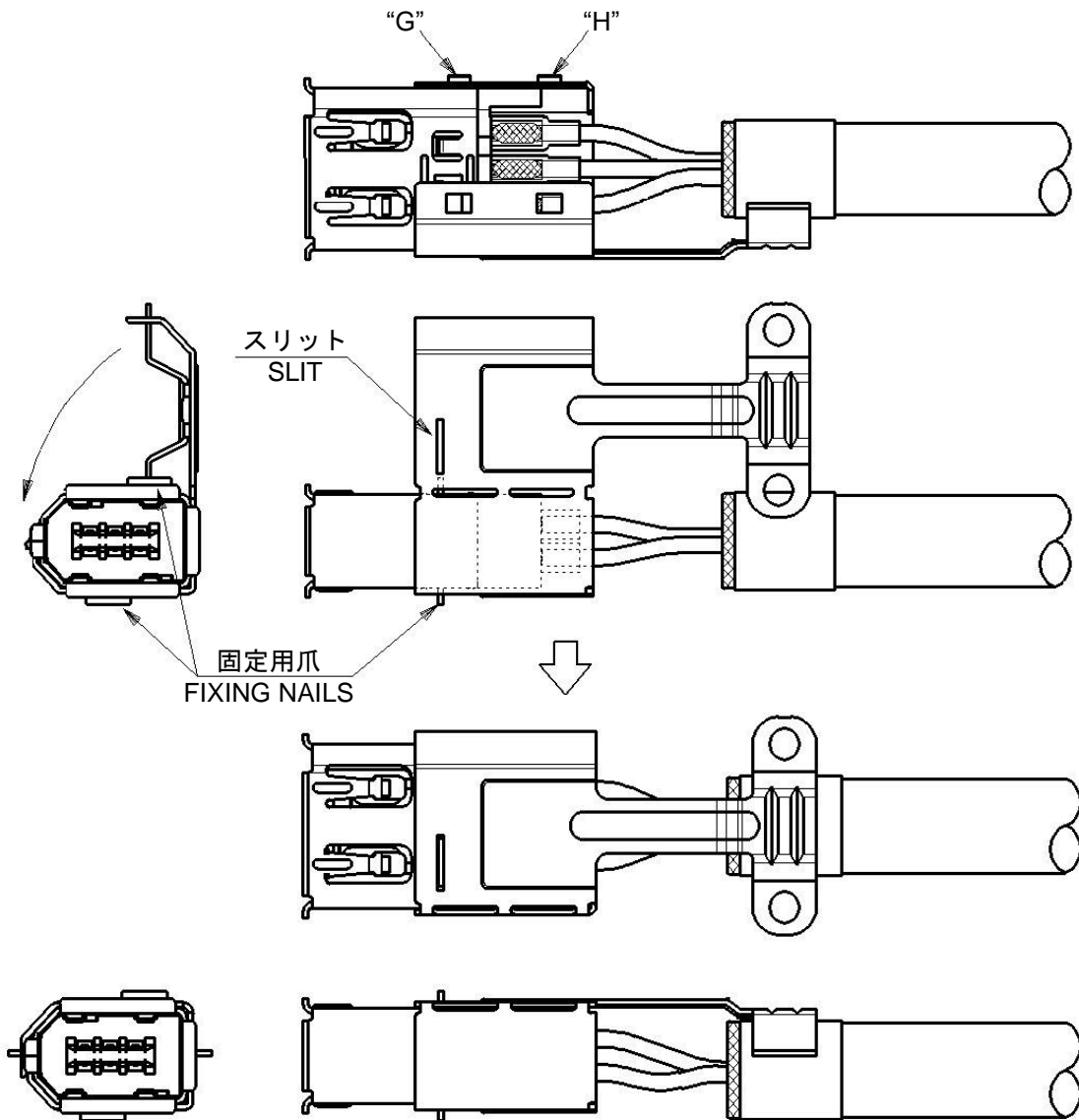
- (1) ターミナル挿入方向は、接点側を向き合わせること。  
INSERT TERMINALS FACE TO FACE INTO HOUSING.
- (2) 挿入後に、正常挿入確認のため軽く電線を引張り、抜けないことを確認すること。  
CHECK WHETHER CRIMPED TERMINALS ARE INSERTED INTO HOUSING FULLY AND CORRECTLY, OR NOT BY PULLING WIRES SLIGHTLY AFTER INSERTION.
- (3) ターミナルの誤挿入、及び不良ターミナル発見の場合は、専用のターミナル引き抜き工具を用いターミナルを交換すること。  
引き抜き工具の取り扱いは、取扱説明書 (IS-0092J) に基づくこと。  
USE AN EXCLUSIVE TERMINAL EXTRACTION TOOL IN CASE OF IRREGULAR INSERTION OR DAMAGED TERMINALS AND CHANGE THEM TO NEW ONES.  
REFER TO THE MANUAL (IS-0092J) AS TO EXCLUSIVE EXTRACTION TOOL.

<b>B</b>	REVISE ON PC ONLY	TITLE: <b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR</b> <b>アプリケーション仕様書</b>			
	SEE SHEET 1 OF 32				
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER	SHEET 26 OF 32
EN-127(2015-12)					

4-3. シェルカバーの組み立て SHELL COVER ASSEMBLING

4-2項の結線が完了したソケットにシェルカバーを装着する。この時、シェルカバーは、  
下図G、H部の2個所でロックする。

ASSEMBLE SHELL COVER TO SOCKET AFTER WIRE TERMINATION OF  
PARAGRAPH 4-2. TO BE LOCKED EXACTLY AT 2 POSITIONS, "G" AND "H" PORTIONS  
IN THE FOLLOWING FIGURE.



REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 27 OF 32
EN-127(2015-12)				

[注意事項 NOTES]

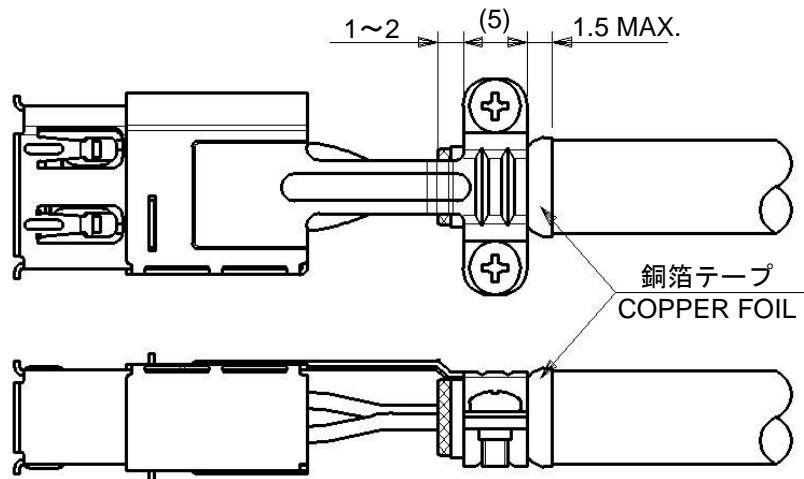
- (1) ソケットの固定用爪が、シェルカバーのスリットに確実に入ること。  
FIT FIXING NAILS OF SOCKET INTO THE SLIT OF SHELL COVER EXACTLY
- (2) ソケットとシェルカバーを組み立てた後、シェルカバーを取り外す場合は、  
シェルカバーのロック部を小型ドライバー等により押し広げロックを解除し取り外すこと。  
取り外したシェルカバーを再度使用する場合は、ロック部の変形を修正すること。  
WHEN DETACHING SHELL COVER FROM SOCKET, UNLOCK SHELL COVER BY EXTENDING  
LOCK PORTION WITH A SCREW DRIVER. REPAIR THE DEFORMATION OF  
LOCK PORTION AND TIP END NAILS OF SHELL COVER WHEN USING THEM AGAIN.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
	<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
	REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER	SHEET 28 OF 32
EN-127(2015-12)					

4-4. ケーブルクランプ CABLE CLAMP ASSEMBLING TO SHELL ASSEMBLY

4-3項の組み立てが完了したシェルにケーブルクランプを装着する。

ASSEMBLE CABLE CLAMP TO AFTER ASSEMBLING SHELL OF PARAGRAPH 4-3.



ネジ締め付けトルク : 0.18~0.21Nm

RECOMMENDED SCREW TIGHTENING TORQUE : 0.18~0.21Nm

[注意事項 NOTES]

(1) 電線には多少の弛みがあること。

MAKE WIRES HAVE SOME SAG AFTER SHELL ASSEMBLING.

(2) ケーブルクランプからの銅箔テープのはみ出し量は、上記の通りとする。

はみ出し量が多い場合は、テープがカバーからはみ出さないので注意すること。

THE AMOUNT OF THE OVERFLOW OF THE COPPER FOIL TAPE FROM THE CABLE CLAMPING IS MADE LIKE THE ABOVE-MENTIONED. NOTE THAT THE TAPE BEGINS TO SEE FROM THE COVER WHEN THE AMOUNT OF THE OVERFLOW IS LONG.

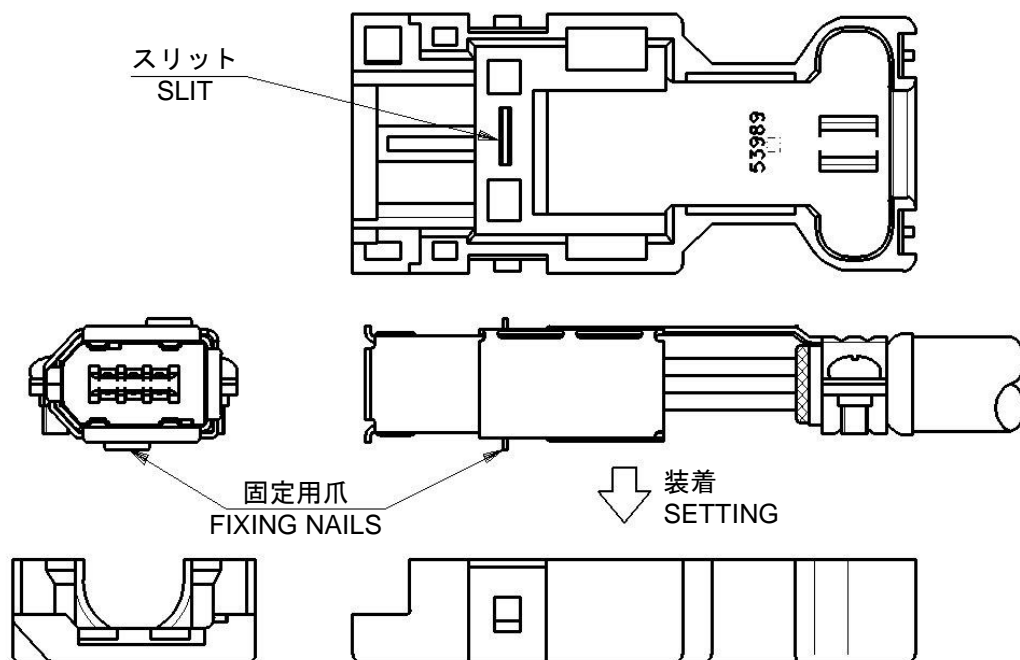
REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 29 OF 32
EN-127(2015-12)				

4-5. モールドカバーへの組み込み MOLD COVER ASSEMBLING TO SHELL ASSEMBLY

4-5-1. モールドカバーAへのコネクタの装着 SHELL ASSEMBLY SETTING TO MOLD COVER A

カバーAに下図で示す方向にコネクタを装着する。

SET SHELL ASSEMBLY ON COVER A IN THE DIRECTION AS FOLLOWS.



[注意事項 NOTES]

(1) コネクタの固定用爪が、カバーAのスリットに確実に入ること。

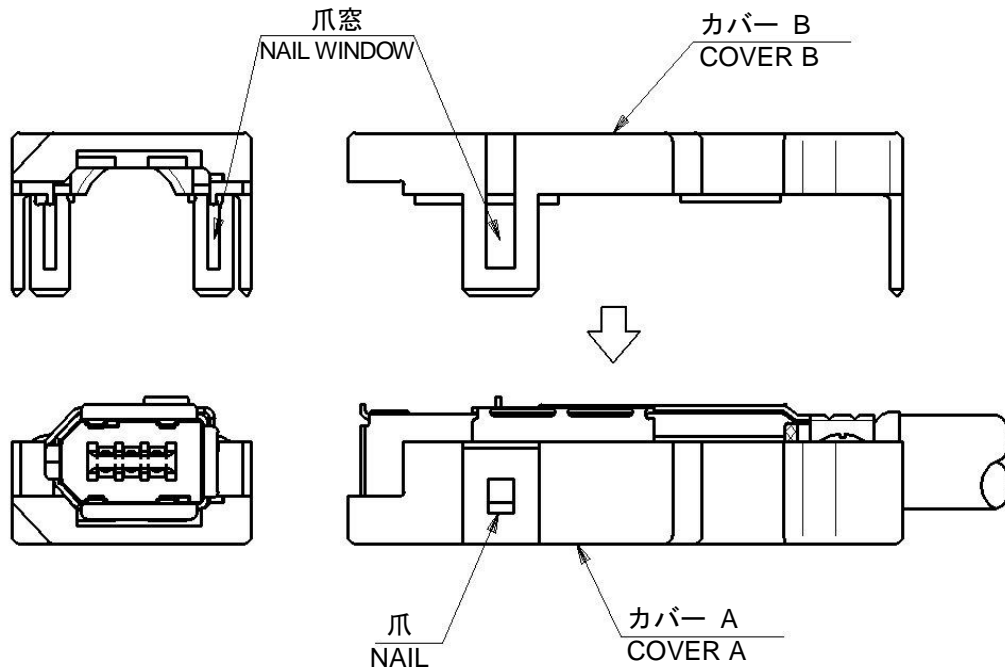
FIT FIXING NAILS OF SHELL ASSEMBLY IN THE SLIT OF COVER A EXACTLY.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 551000680AS		DOC. TYPE PS	DOC. PART A00	CUSTOMER
				SHEET 30 OF 32
EN-127(2015-12)				

## 4-5-2. モールドカバーBの装着 COVER B SETTING

カバーBをカバーAに装着する。

SET COVER B ON COVER A.



### [注意事項 NOTES]

- (1) モールドカバーAの爪にモールドカバーBのロック部（爪窓）を確実にロックさせること。（4箇所）  
LOCK NAIL WINDOWS OF COVER B WITH NAILS OF COVER A EXACTLY. (4 POINTS)
- (2) カバ-装着後、ラッチが正常に作動すること。  
MAKE SURE OF NORMAL ACTION OF LATCHES AFTER ASSEMBLING.

### 【5. その他の注意事項 ANOTHER NOTE】

- (1) カバ-Aとカバ-Bを組み立てた後、カバ-を取り外す場合は、カバ-Bのロック部を小型ドライバー等により押し広げロックを解除し取り外すこと。この時ロック部を損傷させないこと。  
WHEN REMOVING COVER B FROM COVER A AFTER ASSEMBLING, UNLOCK COVER B BY EXTENDING NAIL WINDOWS OF COVER B WITH A SCREW DRIVER. DO NOT DAMAGE NAIL WINDOWS OF COVER B WHEN UNLOCKING.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	<b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR アプリケーション仕様書</b>			
	REV.	DESCRIPTION	<small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION</small>		
DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER	SHEET 31 OF 32
EN-127(2015-12)					



REV.	REV. RECORD	DATE	ECN NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY :
A	RELEASED	2017/09/20	122219	ESATO	KTAKAHASHI
B	REVISED	2017/09/29	122501	ESATO	KTAKAHASHI

REVISE ON PC ONLY		TITLE: <b>2.0mm PITCH I/O CONECTOR</b> <b>アプリケーション仕様書</b>
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 32	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER <b>551000680AS</b>	DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>A00</b>	CUSTOMER	SHEET 32 OF 32
---------------------------------------	------------------------	-------------------------	----------	-------------------

**【1. 適用範囲 SCOPE】**

本仕様書は、\_\_\_\_\_殿 に納入する  
2.0mm ピッチ I/O コネクタ (ソケット : 電線半田付けタイプ/プラグ : 電線半田付けタイプ, ネジタイプシェル)  
について規定する。

This specification covers the 2.0mm PITCH I/O CONNECTOR series.  
(SOCKET :HANDA SOLDER TYPE /PLUG : HANDA SOLDER TYPE, SCREW TYPE SHELL)

**【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】**

製品名称 Product Name		製品型番 Part Number
プラグ Plug Set 55100-0*70 55100-0*80	半田付け式プラグ Solder Type Plug	54180-0*19
	シェルカバー Shell Cover	58299-0*26
	シェルボディ Shell Body	58300-0*26
	モールドカバーA Mold Cover A	54181-0*15
	モールドカバーB Mold Cover B	54182-0*05
ソケット セット Socket Set 54280-0*09	半田付け式ソケット Solder Type socket	53988-0*19
	シェルカバー Shell Cover	58302-0*28
	モールドカバーA Mold Cover A	53989-0*05
	モールドカバーB Mold Cover B	53990-0*05
セット共通部品 Set Common Parts	ケーブルクランプ Cable Clamp	58303-0000
	十字穴付きなべ小ネジ Cross Recessed Head Screw	59832-0009

\* : 図面参照 Refer to the drawing

REV.	C	D																											
SHEET	1-18	1-18																											
REVISE ON PC ONLY											TITLE:																		
<b>D</b>	変更 REVISED 121574 2017/09/08 E.SATO										<b>2.0mm PITCH I/O CONNECTOR</b> <b>-LEAD FREE-</b> <b>製品仕様書</b>																		
	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																												
REV.	DESCRIPTION																												
DESIGN CONTROL									STATUS									WRITTEN BY:			CHECKED BY:			APPROVED BY:			DATE:		
J																		J.SASAMORI			K.TOJO			M.SASAO			2004/05/21		
DOCUMENT NUMBER												DOC. TYPE			DOC. PART			CUSTOMER						SHEET					
PS-54280-005												PS			001			GENERAL MARKET						1 OF 18					

【3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES】

項目 Item	規格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.)	1 2 5 V	
最大許容電流 及び適用電線 Rated Current (MAX.) and Applicable Wires	AWG # 2 2 ~ 1 6	2 . 0 A
	AWG # 2 4	1 . 5 A
	AWG # 2 6	1 . 0 A
	AWG # 2 8	0 . 5 A
使用温度範囲 Ambient temperature Range (Operating and Non-operating)	- 4 0 ° C ~ + 8 5 ° C * 1	

[ A C (実効値 rms) / D C ]  
被覆外径 : φ 2.1mm MAX.  
Insulation O.D.  
シース外径 φ 6.2 ~ φ 7.2 mm  
Sheath Insulation O.D.

\*1 通電による温度上昇分も含む。  
Including terminal temperature rise.

REVISE ON PC ONLY	
<b>D</b>	SEE SHEET 1 OF 18
REV.	DESCRIPTION

TITLE:  
**2.0mm PITCH I/O CONNECTOR**  
**-LEAD FREE-** **製品仕様書**

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER <b>PS-54280-005</b>	DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>001</b>	CUSTOMER <b>GENERAL MARKET</b>	SHEET 2 OF 18
----------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------

【4. 性能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項 目 Item		条 件 Test Condition		規 格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	ターミナル間 Term. To Term.	コネクタを嵌合させ、開放電圧20mV以下、短絡電流10mA以下にて測定する。測定位置は第5項に示す。 電線の導体抵抗は除く。 (EIA-364-23) Mate connectors, measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX. Contact resistance measuring points, see paragraph [5] Except wire conductor resistance (EIA-364-23)	20 milliohm Maximum.
		シェル間 Shell to Shell	コネクタを嵌合させ、開放電圧5V以下、短絡電流100mA以下にて測定する。測定位置は第5項に示す。 (EIA-364-06) Mate connectors, measure contact resistance, 5V MAX., 100mA MAX. Contact resistance measuring points, see paragraph [5] * Except wire conductor resistance. (EIA-364-06)	50 milliohm Maximum..
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	隣接するターミナル間及びターミナル、シェル間に、DC500Vを印加し測定する。(未嵌合) (EIA-364-21) Apply 500V DC between adjacent terminals and terminals and shell. (unmated) (EIA-364-21)		1000 Mega ohm Minimum
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	隣接するターミナル間及びターミナル、シェル間に、AC350V(実効値)を1分間印加する。(未嵌合) (EIA-364-20) Apply 350V AC for 1minute between adjacent terminals and terminals and shell. (unmated) (EIA-364-20)		異常なきこと No Breakdown

REVISE ON PC ONLY

**D**

SEE SHEET 1 OF 18

TITLE:

2.0mm PITCH I/O CONNECTOR

-LEAD FREE-

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER  
PS-54280-005

DOC. TYPE  
PS

DOC. PART  
001

CUSTOMER  
GENERAL MARKET

SHEET  
3 OF 18

4 - 2. 機械的性能 Mechanical Performance

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-2-1	挿入力及び抜去力 Mating Force and Un-mating Force	毎分25±3mmの速さで挿入、抜去を行う。 (EIA-364-13) Mate and un-mate connectors at a rate of 25±3mm / min. (EIA-364-13)	挿入力 Mating Force	39.2N{4kgf} / Maximum
			抜去力 Un-mating Force	9.8N {1Kgf} / Minimum 39.2N{4kgf} / Maximum
4-2-2	ケーブル引張り強度 Cable Axial Pull Test	コネクタを固定し、ケーブルに98N{10Kgf}の引っ張り荷重を1分間加える。  Fix the connector and apply a 98N{10Kgf} load for one minute on cable axis.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			瞬 断 Discontinuity	1 microsecond Maximum
4-2-3	ラッチ強度 Latch Strength	コネクタを嵌合させ、ケーブルに98N{10Kgf}の引っ張り荷重を1分間加える。  Connect male and female together and on the cable for 1 minute apply a load of 98N{10Kgf}.	機 能 Function	異常なきこと No Damage
4-2-4	屈曲性 (プラグ側、ソケット側) Elasticity (Plug side, Socket side)	第7項の図の様にコネクタを嵌合させソケット又は、プラグを固定した状態で1分間に15~20回の速さで上下、左右に各90° 往復180° を1回とし、ケーブルに19.6N~29.4N{2~3Kgf}の張力を加えながら各20回屈曲させる。  Fix the socket or plug connect the cable to it as the figure of paragraph 7. Apply a load of 19.6 to 29.4N {2 to 3Kgf} on the cable and bend the cable to the direction of 90 degrees each on both sides up to 20 cycles.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			機 能 Function	ラッチの外れなきこと No latch unlock
			瞬 断 Discontinuity	1 microsecond Maximum
4-2-5	ターミナル保持力 Terminal / Housing Retention Force	ハウジングに圧入されたターミナルを軸方向に毎分25±3mmの速さで引張る。 Apply axial pull out force of the terminal assembled in the housing at the speed rate of 25±3mm/minute.	9.8N {1.0Kgf} Minimum	

REVISE ON PC ONLY

**D**

SEE SHEET 1 OF 18

TITLE:

2.0mm PITCH I/O CONNECTOR

-LEAD FREE-

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

PS-54280-005

DOC. TYPE

PS

DOC. PART

001

CUSTOMER

GENERAL MARKET

SHEET

4 OF 18

4-3. その他 Mechanical Performance and Others

項 目 Item		条 件 Test Condition		規 格 Requirement	
4-3-1	繰返し挿抜 Repeated Mate / Un-mate	1時間に500±50回の速さで挿入、抜去を1500回繰り返す。 (EIA-364-09) When mate / un-mated up to 1500 cycles repeatedly at the rate of 500±50 cycles/ hour. (EIA-364-09)		挿入力 Mating Force	39.2N{4kgf} / Maximum
				抜去力 Un-mating Force	9.8N {1Kgf} / Minimum 39.2N{4kgf} / Maximum
4-3-2	耐久性 Durability	A	1時間に300回以下の速さで挿入、抜去を5回繰り返す。(手動挿抜) (EIA-364-09) When mate / un-mated up to 5 cycles repeatedly at the rate of 300 MAX. cycles per hour. (by Manual mating / unmating) (EIA-364-09)	接 触 抵 抗 Contact Resistance	初期値からの変化量 Maximum change from initial
		B	1時間に500±50回以下の速さで挿入、抜去を750回繰り返す。(自動挿抜) (EIA-364-09) When mate / un-mated up to 750 cycles repeatedly at the rate of 500±50 cycles per hour. (by Automatic Equipment) (EIA-364-09)		ターミナル間 Term. To Term. 50 milliohm Maximum
4-3-3	耐振動性 Vibration	DC100mA通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に、周波数10~2000~10 Hz (1往復20分)、全振幅1.52mm又は、加速度147mm/S <sup>2</sup> {15G}の振動を各12回ずつ (計36回) 加える。 (EIA-364-28) Amplitude :1.52mm P-P or 147mm/S <sup>2</sup> {15G} Sweep time : 10-2000-10 Hz in 20 minutes. Duration : 12 times in each (total of 36 times) X,Y,Z axes Electrical load : DC 100mA current shall be flowed during the test. (EIA-364-28)		外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
				接 触 抵 抗 Contact Resistance (ターミナル間) (Term to Term.)	初期値からの変化量 :15 milliohm 以下 Maximum change from initial :15 milliohm Maximum
				瞬 断 Discontinuity	1 microsecond Maximum

REVISE ON PC ONLY

**D**

SEE SHEET 1 OF 18

TITLE:

2.0mm PITCH I/O CONNECTOR

-LEAD FREE-

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER  
PS-54280-005

DOC. TYPE  
PS

DOC. PART  
001

CUSTOMER  
GENERAL MARKET

SHEET  
5 OF 18

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-4	耐衝撃性 Shock	DC 100mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 6方向 に、980 m/s <sup>2</sup> {100G}の衝撃を各3回加える。 (EIA-364-27) Mate connectors and subject to the following shock conditions. 3 mutually perpendicular axes, passing DC 100 mA current during the test. (Total of 18 shocks) Test Pulse : Half Sine Peak value : 980 m/s <sup>2</sup> {100G} Duration : 6ms (EIA-364-27)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接 触 抵 抗 Contact Resistance (ターミナル間) (Term to Term.)	初期値からの 変化量 15 milliohm 以下 Maximum change from initial 15 milliohm Maximum
			瞬 断 Discontinuity	1 microsecond Maximum

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
<b>D</b>	SEE SHEET 1 OF 18	2.0mm PITCH I/O CONNECTOR -LEAD FREE- 製品仕様書			
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
REV.	DESCRIPTION	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
		PS	001	GENERAL MARKET	6 OF 18

項 目 Item		条 件 Test Condition		規 格 Requirement	
4-3-5	耐湿性 Humidity	A	コネクタを嵌合させ、第8項に示す温度変化を21サイクル（504hr）連続して行う。但し、段階7a,7bは除く。試験後24時間室温に放置する。 (EIA-364-31) Mate connectors together and repeat the test specified in paragraph [8] up to 21 cycles. But step 7a and 7b is omitted. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 24 hours, after which the specified measurements shall be performed. Temperature : +25~+65°C Relative Humidity : 80~98% Duration : 21 cycle (504hr)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
				接 触 抵 抗 Contact Resistance	初期値からの 変化量 Maximum change from initial
			ターミナル間 Term. To Term.	15 milliohm Maximum	
		B	未嵌合のコネクタに第8項に示す温度変化を4サイクル（96hr）連続して行う。但し、段階7a,7bは除く。試験後24時間室温に放置する。 (EIA-364-31) Unmate connectors together and repeat the test specified in paragraph [8] up to 4 cycles. But step 7a and 7b is omitted. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 24 hours, after which the specified measurements shall be performed. Temperature : +25~+65°C Relative Humidity : 80~98%	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
絶縁抵抗 Insulation Resistance	4-1-2項 満足のこと Must meet 4-1-2				

REVISE ON PC ONLY

**D**

SEE SHEET 1 OF 18

TITLE:

2.0mm PITCH I/O CONNECTOR  
-LEAD FREE- 製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER  
PS-54280-005

DOC. TYPE  
PS

DOC. PART  
001

CUSTOMER  
GENERAL MARKET

SHEET  
7 OF 18



項 目 Item		条 件 Test Condition		規 格 Requirement	
4-3-6	熱衝撃 Thermal Shock	A	コネクタを嵌合させ、 $-55^{+0}_{-3}$ °Cに 30分、 $+85^{+3}_{-0}$ °Cに 30分、これを1サイクルとし、 5サイクルを繰り返す。 但し、温度移行時間は 5分以内とする。 試験後、1~2時間 室温に放置する。 (EIA-364-32) Mate connectors and subject to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 1 cycle a) $-55^{+0}_{-3}$ °C 30 minutes b) $+85^{+3}_{-0}$ °C 30 minutes ( Transit time shall be within 5 minutes ) (EIA-364-32)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
				接 触 抵 抗 Contact Resistance	初期値からの変化量 Maximum change from initial
		B	未嵌合のコネクタを $-55^{+0}_{-3}$ °Cに 30分、 $+85^{+3}_{-0}$ °Cに 30分、これを1サイクルとし、 10サイクルを繰り返す。 但し、温度移行時間は 5分以内とする。 試験後、1~2時間 室温に放置する。 (EIA-364-32) Unmate connectors and subject to the following conditions for 10 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 1 cycle a) $-55^{+0}_{-3}$ °C 30 minutes b) $+85^{+3}_{-0}$ °C 30 minutes ( Transit time shall be within 5 minutes ) (EIA-364-32)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
				絶縁抵抗 Insulation Resistance	4-1-2項 満足のこと Must meet 4-1-2

REVISE ON PC ONLY

**D**

SEE SHEET 1 OF 18

TITLE:

2.0mm PITCH I/O CONNECTOR

-LEAD FREE-

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

PS-54280-005

DOC. TYPE

PS

DOC. PART

001

CUSTOMER

GENERAL MARKET

SHEET

8 OF 18

項 目 Item		条 件 Test Condition		規 格 Requirement	
4-3-7	混合ガス Mixed Flowing Gas	A	未嵌合のコネクタを 30±2℃に、相対湿度70±2%にて、10±3ppb の塩素ガスと200±50ppb の二酸化窒素ガスと10±5ppb の硫化水素ガスの混合ガス中に24時間放置する。 Unmate connectors and expose to a mixture of 10±3ppb Cl <sub>2</sub> gas, 200±50ppb NO <sub>2</sub> gas and 10±5ppb H <sub>2</sub> S gas, ambient temperature 30±2℃, relative humidity 70±2% for 24 hours.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
				接 触 抵 抗 Contact Resistance	初期値からの変化量 Maximum change from initial
		ターミナル間 Term. To Term.	15 milliohm Maximum		
		B	コネクタを嵌合し、30±2℃に、相対湿度70±2%にて、10±3ppb の塩素ガスと200±50ppb の二酸化窒素ガスと10±5ppb の硫化水素ガスの混合ガス中に240時間放置する。 Mate connectors and expose to a mixture of 10±3ppb Cl <sub>2</sub> gas, 200±50ppb NO <sub>2</sub> gas and 10±5ppb H <sub>2</sub> S gas, ambient temperature 30±2℃, relative humidity 70±2% for 240 hours.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
接 触 抵 抗 Contact Resistance	初期値からの変化量 Maximum change from initial				
	ターミナル間 Term. To Term.	15 milliohm Maximum			
シェル間 Shell To Shell.	50 milliohm Maximum				
4-3-8	耐 熱 性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、70±2℃ の雰囲気中に250時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (EIA-364-17) Mate connectors and exposed to the conditions of 70±2℃ for 250 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions of 1 to 2 hours, after which the specified measurement shall be performed. (EIA-364-17)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage	
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	初期値からの変化量 Maximum change from initial	
				ターミナル間 Term. To Term.	15 milliohm Maximum
			シェル間 Shell To Shell.	50 milliohm Maximum	
抜去力 Un-mating Force	4-2-1項 満足のこと Must meet 4-2-1				

REVISE ON PC ONLY

**D**

SEE SHEET 1 OF 18

TITLE:

**2.0mm PITCH I/O CONNECTOR**

**-LEAD FREE-**

**製品仕様書**

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

**PS-54280-005**

DOC. TYPE

**PS**

DOC. PART

**001**

CUSTOMER

**GENERAL MARKET**

SHEET

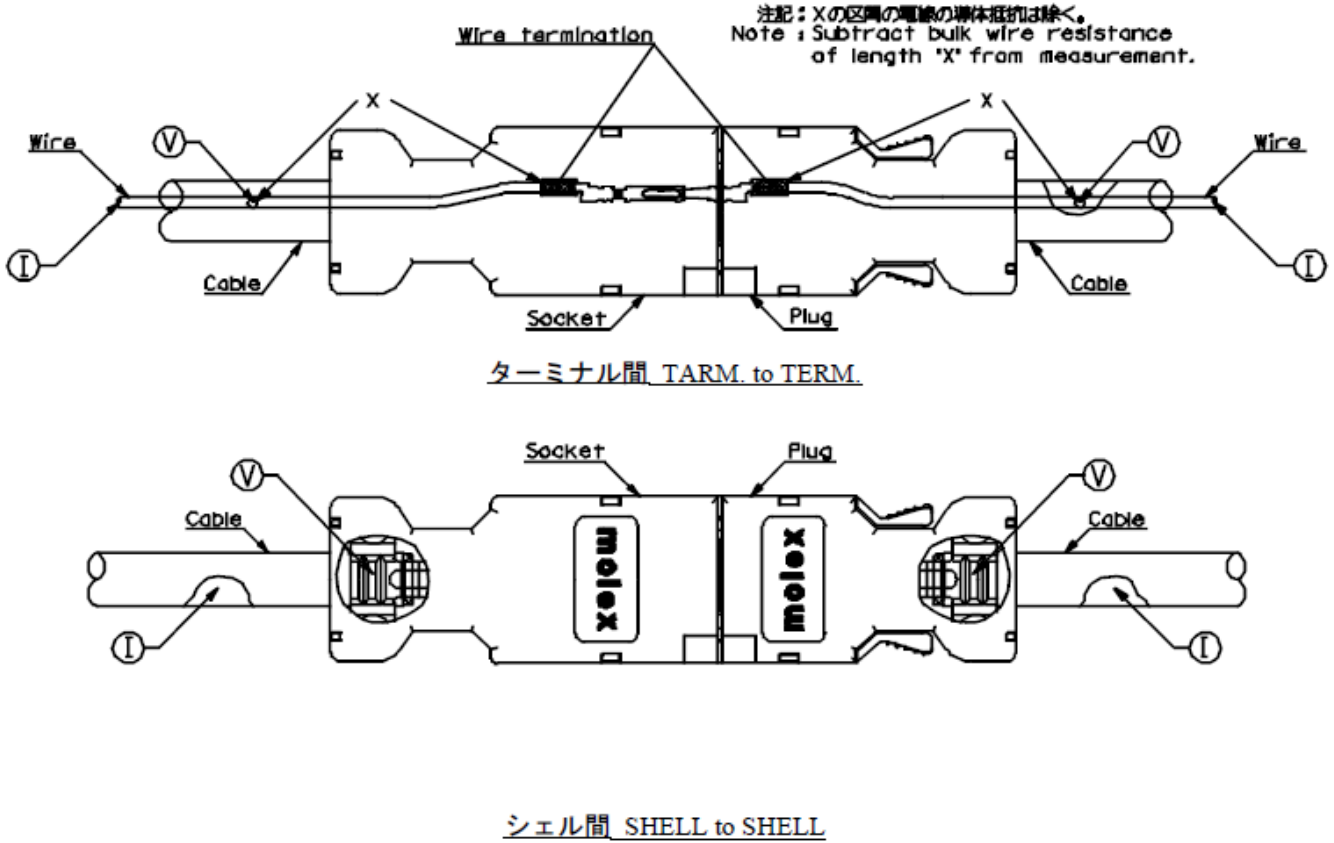
9 OF 18

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement		
4-3-9	塩水噴霧 Salt Spray	適合するコネクタを嵌合させ、35±2°Cにて 5±1%重量比の塩水を48±4時間噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11 / MIL-STD-202 試験法101) Mate connectors and expose to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution cocentration : 5±1% Spray time : 48±4 hours Ambient temperature : 35±2°C (JIS C60068-2-11 / MIL-STD-202 Method 101)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage	
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	初期値からの変化量 Maximum change from initial	
				ターミナル間 Term. To Term.	15 milliohm Maximum
			シェル間 Shell To Shell.	50 milliohm Maximum	
4-3-10	半田付け性 Solderability	端子先端より1.0mmの位置まで、245±3°Cの半田に3±0.5秒浸す。 Dip soldertails into the molten solder(held at 245±3°C) up to 1.0mm from the bottom of the housing for 3±0.5sec.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes	
4-3-11	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	<u>手半田時</u> (Reflow by Manual Soldering iron) 端子先端、及び金具先端より0.2mmの位置まで、350±10°Cの半田ゴテにて5秒加熱する。但し、異常な加圧のないこと。 Using a soldering iron (350±10 degrees C for 5 seconds) heat up the area 0.2mm from the tip of the solder tails and fitting nails. However, do not apply excessive pressure to either the terminals or fitting nails.	外 観 Appearance	端子ガタ、割れ等 異常なきこと No Damage	

( ) : 参考規格 Reference Standard

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
<b>D</b>	SEE SHEET 1 OF 18	2.0mm PITCH I/O CONNECTOR			
		-LEAD FREE- 製品仕様書			
REV. DESCRIPTION		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER PS-54280-005		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 10 OF 18

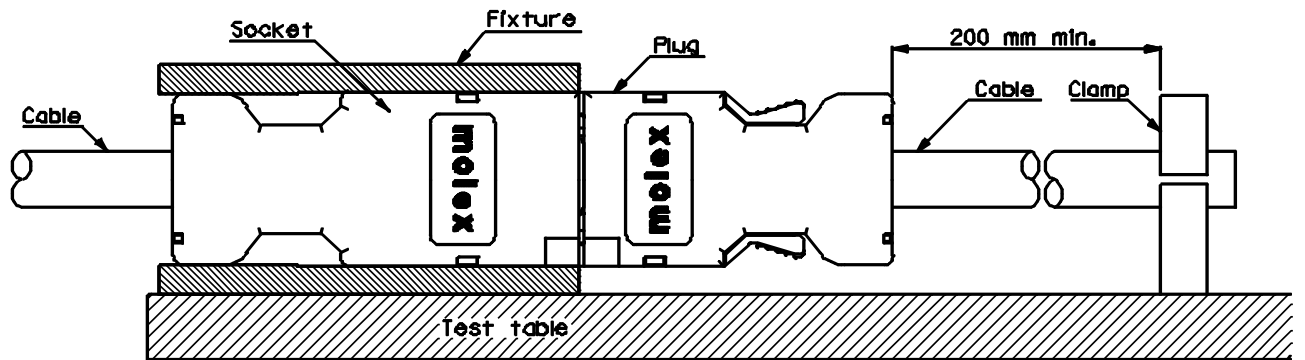
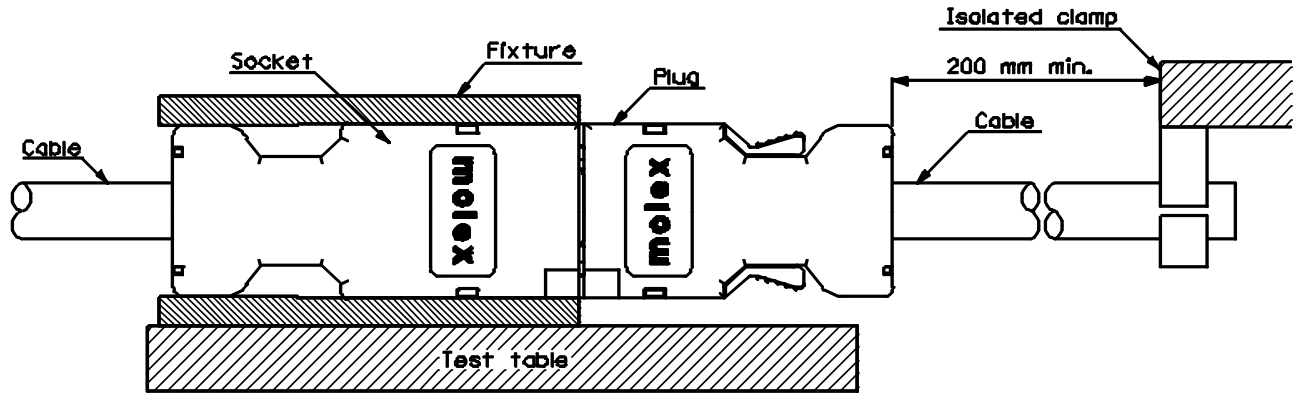
【5. 接触抵抗測定位置 CONTACT RESISTANCE MEASURING POINTS】



REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
<b>D</b>	SEE SHEET 1 OF 18	2.0mm PITCH I/O CONNECTOR -LEAD FREE- 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER PS-54280-005		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 11 OF 18
EN-127(2015-12)					

【6. 耐振動性・耐衝撃性試験 VIBRATION AND SHOCK FIXTURING DIAGRAM】

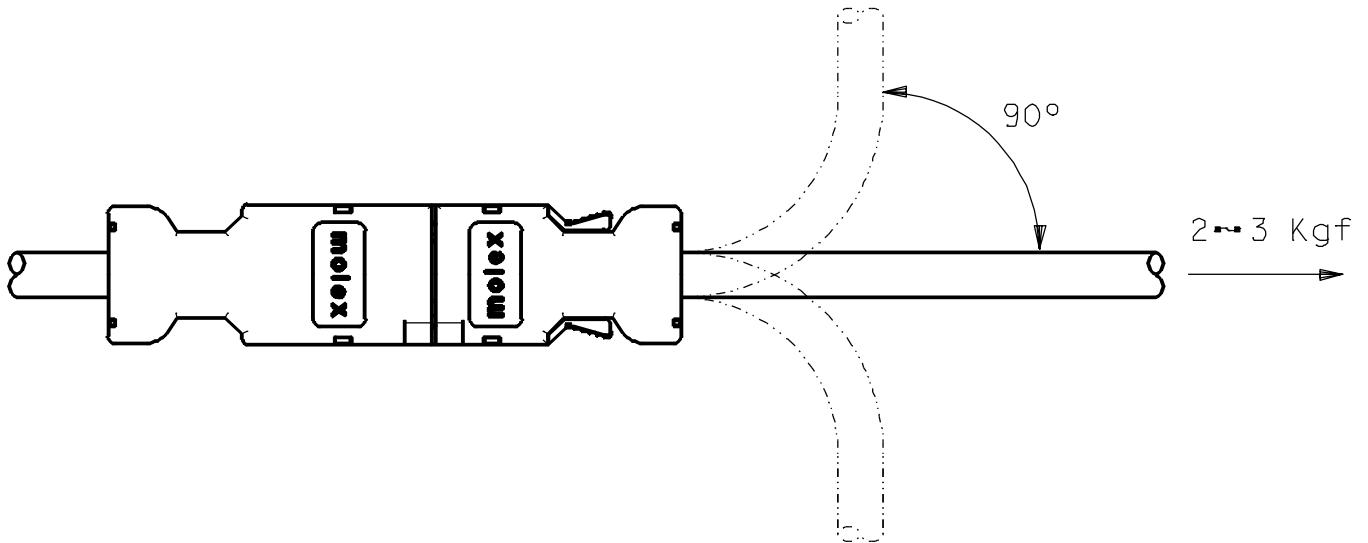
耐振動試験 VIBRATION TEST



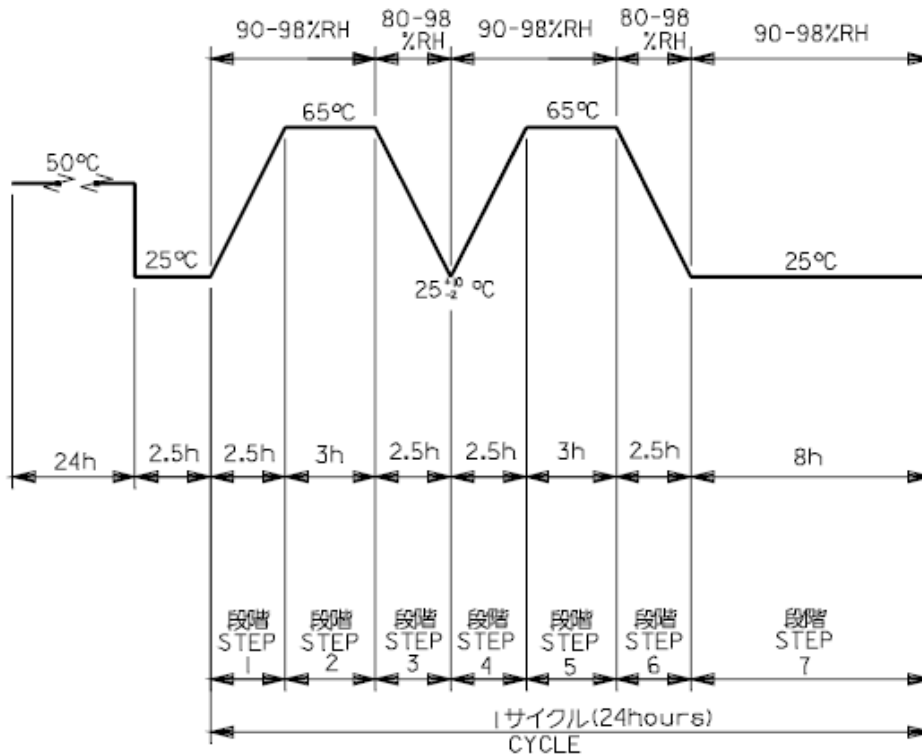
耐衝撃性試験 SHOCK TEST

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>D</b>	SEE SHEET 1 OF 18	2.0mm PITCH I/O CONNECTOR -LEAD FREE- 製品仕様書		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER PS-54280-005		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET
				SHEET 12 OF 18
EN-127(2015-12)				

【7. 屈曲性試験方法 ELASTICITY TEST DIAGRAM】



【8. 耐湿性試験条件 HUMIDITY CONDITIONS】



REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
<b>D</b>	SEE SHEET 1 OF 18	2.0mm PITCH I/O CONNECTOR -LEAD FREE- 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER PS-54280-005		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 13 OF 18
EN-127(2015-12)					

【9. 試験シーケンス TEST SEQUENCE】

項 目 Item		グループ Group						
		A	B	C	D 1	D 2	E	F
1	外 観 Appearance	①	①	①	①	①	①	①
2	接触抵抗 Contact Resistance	ターミナル間 Term. to Term. ② ④ ⑥	② ④ ⑥		② ⑤ ⑧ ⑪	② ⑤ ⑧ ⑪	② ⑤	③ ⑥
	シェル間 Shell to Shell				③ ⑥ ⑫	③ ⑥ ⑫		
3	絶縁抵抗 Insulation Resistance			⑤ ⑦				
4	耐電圧 Dielectric Strength			② ④				
5	耐久性 Durability	A			④ ⑨			
		B				④ ⑨		
6	耐振動性 Vibration	③						
7	耐衝撃性 Shock	⑤						
8	耐熱性 Temperature Life							⑤
9	耐湿性 Humidity	A	⑤					
		B		⑥				
10	熱衝撃 Thermal Shock	A	③					
		B		③				
11	混合ガス Mixed Flowing Gas	A			⑦			
		B			⑩	⑦ ⑩		
12	塩水噴霧 Salt Spray						④	
13	挿入力及び抜去力 Mating Force and Un-mating Force							② ⑧
試料数 Number of samples		2 SET	2 SET	2SET	2 SET	2 SET	2 SET	2 SET

REVISE ON PC ONLY	
<b>D</b>	SEE SHEET 1 OF 18
REV.	DESCRIPTION

TITLE: 2.0mm PITCH I/O CONNECTOR  
-LEAD FREE- 製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER PS-54280-005	DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 14 OF 18
---------------------------------	-----------------	------------------	----------------------------	-------------------

EN-127(2015-12)

項目 Item	グループ Group				
	G	H	I	J	K
1 外観 Appearance	①	①	①	①	①
1 3 挿入力及び抜去力 Mating Force and Un-mating Force	② ④				
1 4 繰り返し挿抜 Repeated Mate/Un-mate	③				
1 5 ケーブル引張り強度 Cable Axial Pull Test		②			
1 6 ラッチ強度 Latch Intensity			②		
1 7 屈曲性 Elasticity			②		
1 8 ターミナル保持力 Terminal / Housing Retention Force				③	
1 9 半田付け性 Solderability					②
2 0 半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat					②
試料数 Number of samples	2 SET	5 SET	2SET	5 PIN	2SET

【10. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照 Refer to the drawing.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
<b>D</b>	SEE SHEET 1 OF 18	2.0mm PITCH I/O CONNECTOR -LEAD FREE- 製品仕様書			
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
REV.	DESCRIPTION	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
		PS	001	GENERAL MARKET	15 OF 18
DOCUMENT NUMBER PS-54280-005					



【11. 取り扱いの注意事項 INSTRUCTION UPON USAGE】

- 11-1. 本製品のシェル表面に多少の傷が確認される事がありますが製品性能に影響ございません。  
Although this product may have a small scratch on the metal shell, this will have no influence on the product' s performance.
- 11-2. 成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、製品性能には影響ありません。  
There may be slight differences in the housing coloring, but there will be no influence on the product' s performance.
- 11-3. 本製品をご使用時には、1PIN当りの定格以上の電流を複数の回路に分岐しての使用は避けて下さい。  
When using this product, please ensure that the specification for rated current per circuit is followed. Do not allow the sum of the current used on several circuits to exceed the maximum allowable current.
- 11-4. 本製品及び加工工程品（仕掛品）や加工品（ハーネス品）において、梱包及び輸送・保管時において、コネクタ間での絡みや衝撃、積み重ね等による負荷が掛からないようにして下さい。  
変形・破損等による性能不良の原因となります。
- 11-5. コネクタに外力が加わらないようにクリアランスをあけた筐体構造にして下さい。  
Please keep enough clearance between connector and chassis of your application in order not to apply pressure on the connector.
- 11-6. コネクタの嵌合を取り外す際は、必ずロックを解除して行って下さい。  
電線はまとめて軽く掴み、指全体で確実にロックを解除し、取り出して下さい。  
Please detach the connector lock before unmating the connector. Please secure all the wires together softly, release the lock completely with a finger, and then unmate the connector.
- 11-7. 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向への負荷がかかるような動作またはセットはしないでください。コネクタ破壊やはんだクラックを引き起こします。  
After mated the connector, please do not allow the printed circuit boards to apply pressure on the connector in either the pitch direction or the span direction. It may cause damage to the connector and may crack the soldering.
- 11-8. 実装後において半田こてによる手修正を行う際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行って下さい。  
条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等、破損の原因になります。  
When conducting manual repairs using a soldering iron, please follow the soldering conditions shown in the product specification. If the conditions in the product spec are not followed, it may cause the terminals to fall off, a change in the contact gap, a deformation of the housing, melting of the housing, and damage the connector.
- 11-9. 半田こてによる手修正を行なう際、過度の半田やフラックスを使用しないで下さい。半田上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合があります。  
When conducting manual repairs using a soldering iron, please do not use more solder and flux than needed. This may cause solder wicking and flux wicking issues, and it will eventually cause a contact defect and functional issues.

	REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
<b>D</b>	SEE SHEET 1 OF 18	<b>2.0mm PITCH I/O CONNECTOR</b> <b>-LEAD FREE-</b> <span style="float: right;"><b>製品仕様書</b></span>		
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
REV.	DESCRIPTION			
DOCUMENT NUMBER <b>PS-54280-005</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>001</b>	CUSTOMER <b>GENERAL MARKET</b>
				SHEET 16 OF 18
EN-127(2015-12)				

- 11-10. ハーネス加工品及びコネクタ嵌合後の電線の引き回しの際、引張りによる力が加わりますと、接点部、結線部（圧着部、圧接部）やロック部（端子ロック部）が損傷を受け、接触不良の原因となります。電線の引回し配線をされる場合、コネクタに無理な外力が加わらないように、電線に緩みを持たせ、余裕を持たせる処置をして下さい。  
The cable assembly should not have a constant stress or pulling force applied on it when it is in the mated condition. This phenomenon may damage the contact area or wiring area (crimping/IDT). Therefore, when designing the wire positioning, please ensure that there is enough length of wire to avoid stress on the
- 11-11. 本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部（接点部）が常に動いてしまう状態での御使用は避けて下さい。接触部の摺動磨耗等による接触不良の原因となります。従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、共振を抑える等の処置をお願い致します。  
Please do not use the connector in a condition where the wire, the printed circuit board, or the contact area is experiencing a sympathetic vibration of wires and printed circuit board, and constant movement of devices. This may cause a defect in the contact due to the contact area being worn down. Therefore, please fix wires and printed circuit board on the chassis, and reduces sympathetic vibration.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
<b>D</b>	SEE SHEET 1 OF 18	2.0mm PITCH I/O CONNECTOR -LEAD FREE- <b>製品仕様書</b>		
REV.		DESCRIPTION		
DOCUMENT NUMBER PS-54280-005		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET
				SHEET 17 OF 18
EN-127(2015-12)				

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY :
A	新規作成 RELEASED	2004/05/21	J2004-4383	J.SASAMORI	K.TOJO
B	変更 REVISED	2015/10/05	J2015-0327	Y.SHIBATA	A.MIZUMURA
C	変更 REVISED	2017/07/06	119030	T.NAKAGAWA	K.TAKAHASHI
D	変更 REVISED	2017/09/07	121574	T.NAKAGAWA	K.TAKAHASHI

<b>D</b>	REVISE ON PC ONLY	<b>TITLE:</b> 2.0mm PITCH I/O CONNECTOR -LEAD FREE- 製品仕様書			
	SEE SHEET 1 OF 18				
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER <b>PS-54280-005</b>		DOC. TYPE <b>PS</b>	DOC. PART <b>001</b>	CUSTOMER <b>GENERAL MARKET</b>	SHEET 18 OF 18